

股票简称：华峰测控

股票代码：688200



北京华峰测控技术股份有限公司

Beijing Huafeng Test&Control Technology Co.,Ltd.

(北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼1至5层101、102、103)

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

摘要

保荐人（主承销商）



中国国际金融股份有限公司

(住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

二零二六年九月

声 明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、不满足投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转债，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由公司股东大会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转债回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募投项目正常实施的风险。

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《2026年北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：CCXI-20250988D-03），发行人主体信用评级为AAsti，本次可转换公司债券信用评级为AAsti，评级展望为稳定。

本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项

本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。

四、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险。

（一）应收账款回收风险

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司应收账款账面价值分别为 26,277.87 万元、32,578.11 万元和 55,366.09 万元，占流动资产的比例分别为 9.95%、11.10%及 16.31%。未来随着公司销售业务规模的扩大和销售收入的增长，应收账款存在进一步增长和波动的可能。若公司客户出现经营不善或其他重大不利变化情形，从而不能及时还款，公司发生坏账损失的可能性将增加，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

（二）毛利率下降的风险

2023 年、2024 年及 2025 年，公司综合毛利率分别为 71.19%、73.31%和 73.79%，整体保持稳定。公司综合毛利率情况受产品结构变化、各类成本管控、市场竞争程度、技术更新换代、政策变动等因素影响，如果未来上述影响因素发生重大不利变化，或如果公司无法长期维持并加强在技术创新能力和工艺水平方面的竞争优势以获得较高毛利水平，公司毛利率存在下降的风险。

（三）募投项目实施相关风险

1、募投项目研发成果不达预期的风险

本次募投项目是基于公司产品技术研发能力、行业技术发展趋势、国家产业政策等

综合因素决定的。本次募投项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但自研 ASIC 芯片难度较高，需深度融合电路设计、信号处理、算法优化等多领域知识，精准贴合半导体测试系统的复杂功能需求，稍有偏差便可能影响芯片性能与稳定性，使公司面临本次募投项目研发成果不达预期的风险。

2、募投项目研发费用影响公司盈利能力的风险

本次募投项目拟投入“基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目”，拟投入研发费用合计 69,122.00 万元，建设期 4 年，平均每年研发费用 17,280.50 万元。若公司生产经营产生效益不足以弥补研发费用，公司未来将可能面临净利润水平下滑、净资产收益率下降和毛利率水平下降的风险，从而对公司的盈利能力造成一定的负面影响。

3、募投项目租赁物业落实的风险

本次募投项目涉及租赁办公物业用于研发人员办公，虽然目前办公物业相对丰富，公司对该等物业并无特殊的选定要求，但如果公司无法根据需要及时寻求到适合的场地或租金价格高于行业水平，将可能影响本次项目实施计划。

（四）宏观经济波动的风险

半导体产业处于整个电子信息产业链的顶端，是各种电子终端产品得以运行的基础，与宏观经济形势密切相关，具有周期性特征。近年来，随着 5G 通讯、物联网、汽车电子等新兴领域逐渐兴起及人工智能、大数据、云计算等技术逐渐成熟，全球半导体市场规模总体保持增长。未来，如果宏观经济形势发生重大变化、半导体行业景气度下滑，半导体企业的资本性支出延缓或减少，亦或由于国内半导体行业部分领域出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在行业景气度较低时超过市场需求出现过剩，将对发行人的经营业绩产生一定的不利影响。

（五）半导体测试系统行业竞争加剧的风险

目前全球半导体专用设备市场仍由海外制造商主导，泰瑞达、爱德万等国际知名企业占据了全球半导体测试系统行业的主要份额，市场集中度较高。随着我国半导体设备企业的壮大以及进口替代进程加速，可能导致市场竞争加剧或吸引潜在进入者。若公司无法保持较好的技术水平或进行有效的市场应用推广，则可能导致公司客户流失、市场份额降低，从而对发行人的盈利能力带来不利影响。

（六）研发及技术迭代风险

半导体测试系统整体技术壁垒较高，公司在模拟及数模混合信号测试领域已形成一定竞争力，当前产品线主要覆盖模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路测试，并在高精度参数测试、多工位并行测试等核心技术上构建公司竞争地位。在高端数字测试和先进制程测试覆盖能力上，若相关技术研发进度不及预期，或无法满足先进制程芯片的测试需求，可能导致产品线拓展受限，影响公司在高端测试市场的竞争力，进而对经营业绩产生影响。

（七）其他风险

1、本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，将对企业生产经营产生负面影响。本次发行的可转债未提供担保。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的承兑能力。

2、可转债到期未能转股的风险

本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临较大的资金压力。

3、可转债发行摊薄即期回报的风险

本次可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。本次可转债发行有助于公司增强盈利能力、提高抗风险能力。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

4、可转债交易价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、本公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。

可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现波动，从而影响投资者的投资收益。为此，本公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

5、可转债存续期内转股价格向下修正导致公司原有股东股本摊薄程度扩大的风险

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

可转债存续期内，若公司股票触发上述条件则本次可转债的转股价格将向下做调整，在同等转股规模条件下，公司转股股份数量也将相应增加。这将导致原有股东股本摊薄程度扩大。因此，存续期内公司原有股东可能面临转股价格向下修正条款实施导致的股本摊薄程度扩大的风险。

6、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度存在不确定性的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期间，由于修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价格向下修正条款可能无法实施。此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。并且，公司董事会审议通过的本次可转债转股价格向下修正方案可能未能通过公司股东大会审议。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。此外，即使公司决议向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。

7、可转债提前赎回的风险

本次可转债设有有条件赎回条款，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会会有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。如果公司行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

8、可转债转换价值降低的风险

公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因此可转债的转换价值可能降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格或者即使公司向下修正转股价格但公司股票价格仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

9、不可抗力的风险

在公司日常经营过程中，尽管公司制定了较为完善的危机公关预案，但不排除包括政治、政策、经济、自然灾害等在内的不可控因素可能会对本公司的正常生产经营产生不利影响，提示投资者关注相关风险。

五、关于公司的股利分配政策

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

“第一百六十九条 利润分配的基本原则

（一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，

兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

(二) 公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

(三) 公司按照合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。

(四) 公司优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的应采用现金分红进行利润分配。

第一百七十条 公司利润分配具体政策：

(一) 利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润。

(二) 利润分配的期间间隔：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司原则上每年度进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(三) 公司现金分红的具体条件和比例：除重大投资计划或重大现金支出等特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的 10%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

1. 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000 万元；

2. 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%；

3. 公司未来 12 个月内拟进行研发项目投入累计支出预计达到或超过最近一期经审计净资产的 10%；

4. 当年经营活动产生的现金流量净额为负。

(四) 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程

序，提出差异化的现金分红政策：

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司董事会可根据公司的经营发展情况及前项规定适时依照公司章程规定的程序修改本条关于公司发展阶段的规定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。公司在采用股票方式分配利润时，应当兼顾公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

第一百七十一条 公司利润分配方案的审议程序：

（一）董事会在考虑对全体股东持续、稳定的回报的基础上，应与独立董事、监事充分讨论后，制定利润分配方案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（二）公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或者拟定的现金分红比例未达到第一百六十九条规定的，股东大会审议利润分配方案时，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（三）公司因前述第一百七十一条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项

说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司《公司章程》的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

第一百七十二条 董事会应就利润分配政策的制定或修改做出方案，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十三条 公司利润分配政策的变更：在遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影响的情形时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经1/2以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。”

（二）最近三年公司利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

（1）公司2023年度利润分配情况

2024年5月16日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5.6元（含税），合计派发现金红利75,707,009.84元（含税）。

（2）公司2024年度利润分配情况

2024年9月12日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，公司以实施2024年半年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），以此计算合计拟派发现金红利31,110,565.21元

（含税）。

2025年4月3日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），共计派发现金红利101,447,495.25元（含税）。

（3）公司2025年度利润分配情况

2026年4月28日，公司召开董事会，确定了2025年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.90元（含税），共计拟派发现金红利人民币161,184,440.90元（含税）。

同时，董事会决议确定了2025年度资本公积转增股本方案，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。以公司截至2026年4月20日的总股本135,559,510股，扣减回购专用证券账户中的股份数110,400股，以此计算合计转增65,015,573股。转增后公司总股本将增加至200,575,083股。

2026年5月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，确定股权登记日为2026年6月10日，除权（息）日及现金红利发放日为2026年6月11日，新增无限售条件流通股份上市日为2026年6月11日。

2、最近三年现金股利分配情况

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润	53,609.61	33,391.48	25,165.23
现金分红（含税）	16,118.44	13,255.81	7,570.70
当年现金分红占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例	30.07%	39.70%	30.08%
最近三年累计现金分配合计			36,944.95
最近三年年均可分配利润			37,388.77
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例			98.81%

注1：上述分红金额暂未考虑回购。

（三）公司未来三年分红规划

根据《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司章程规定，公司于2025年1月24日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《北京华峰测控技术股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，并于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》。

六、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施和承诺

（一）公司应对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

由于本次发行可能导致公司每股收益有所下降，为有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司持续回报股东的能力，公司将采取多项措施，具体如下：

1、提升公司的盈利能力和发展潜力，扩大公司业务规模

公司将继续立足于高端半导体质量控制领域相关核心关键技术的研发，并加快推动技术产业化应用工作，一方面，公司将持续增强现有产品竞争力，拓展优质客户，提高公司的市场地位、盈利能力和综合实力；另一方面，公司也将继续加强对新产品的研发力度，加快推动新产品的产业化进程。

2、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的要求制定了募集资金管理办法，对募集资金的专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制、信息披露、监督和责任追究等内容进行了明确的规定，公司将根据相关法律法规和募集资金管理办法的相关要求，规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目。

本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐人对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

3、完善公司治理结构，提升经营和管理效率

公司将严格遵循相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权；为公司发展提供制度保障，提升经营和管理效率。

4、完善利润分配政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司已制定了健全有效的利润分配政策和股东回报机制。公司将严格执行《公司章程》等相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报。由于公司经营所面临的风险客观存在，上述填补回报措施的实施，不等于对公司未来利润做出保证。

（二）公司的控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于本次发行摊薄即期回报填补措施的承诺

1、公司控股股东、实际控制人的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作如下承诺：

“（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（2）切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本公司本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应责任；

（3）自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本公司本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所

的最新规定出具补充承诺。”

2、公司董事、高级管理人员的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）承诺对本人相关的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）若公司未来实施新的股权激励计划，承诺股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”

七、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事及高级管理人员关于本次可转债发行认购事宜及减持情况的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员关于本次可转债发行认购事宜及减持情况的承诺

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员就本次可转债发行认购事宜及减持情况作出如下承诺：

1、如公司启动本次可转债发行，本人将按照相关法律法规关于股票及可转债交易的规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本人及本人配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的最后一次减持日期间隔不满六个月（含）的，本人及本

人配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债；

2、若本人及本人配偶、父母、子女认购本次发行的可转债的，本人承诺，本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守相关法律法规关于股票及可转债交易的规定，在认购本次发行的可转债后六个月内不减持公司的股票或可转债；

3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束，并承诺将严格遵守相关法律法规关于股票及可转债交易的规定。若本人及本人配偶、父母、子女违反上述规定或本承诺，应依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失，本人将依法承担赔偿责任；

4、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（二）独立董事关于本次可转债发行认购事宜的承诺

公司独立董事关于本次可转债发行认购事宜作出如下承诺：

1、本人及本人配偶、父母、子女承诺不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的发行认购；

2、本人及本人配偶、父母、子女自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人配偶、父母、子女违反上述承诺，本人及本人配偶、父母、子女将依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人及本人配偶、父母、子女将依法承担赔偿责任。

目 录

声 明	2
重大事项提示	3
一、不满足投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持本次可转债不能转股的风险	3
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级	3
三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项	4
四、特别风险提示	4
五、关于公司的股利分配政策	8
六、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施和承诺	13
七、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事及高级管理人员关于本次可转债发行认购事宜及减持情况的承诺	15
目 录	17
第一节 释义	21
第二节 本次发行概况	25
一、发行人基本情况	25
二、本次发行的背景和目的	26
三、本次发行的基本情况	27
四、本次发行有关机构	41
五、发行人与本次发行相关机构的关系	43
第三节 风险因素	错误！未定义书签。
一、与发行人相关的风险	错误！未定义书签。
二、与行业相关的风险	错误！未定义书签。
三、其他风险	错误！未定义书签。
第四节 发行人基本情况	45
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况	45
二、科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施	45
三、公司组织结构及重要权益投资情况	47

四、控股股东及实际控制人的基本情况	54
五、发行人、控股股东、实际控制人以及发行人董事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况以及与本次发行相关的承诺事项	58
六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员基本情况	错误！未定义书签。
七、公司的特别表决权股份或类似安排	错误！未定义书签。
八、协议控制架构	错误！未定义书签。
九、公司所处行业基本情况	错误！未定义书签。
十、公司主营业务的具体情况	错误！未定义书签。
十一、技术与研发情况	错误！未定义书签。
十二、公司主要固定资产、无形资产情况	错误！未定义书签。
十三、公司拥有的特许经营权情况	错误！未定义书签。
十四、发行人报告期内重大资产重组情况	错误！未定义书签。
十五、公司的境外经营情况	错误！未定义书签。
十六、报告期内的分红情况	错误！未定义书签。
十七、最近三年公开发行的债券或者其他债务是否存在违约或延迟支付本息的情形	错误！未定义书签。
十八、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况	错误！未定义书签。
十九、本次发行符合理性融资，合理确定融资规模	错误！未定义书签。
第五节 财务会计信息与管理层分析	62
一、最近三年财务报表审计情况	62
二、最近三年财务报表	62
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况	67
四、最近三年主要财务指标及非经常性损益明细表	68
五、会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正	70
六、财务状况分析	72
七、经营成果分析	100
八、现金流量分析	114
九、资本性支出分析	116
十、技术创新分析	117

十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项及重要期后事项	119
十二、本次发行的影响	121
第六节 合规经营与独立性	错误！未定义书签。
一、公司报告期内受到的行政处罚情况	错误！未定义书签。
二、公司及董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况	错误！未定义书签。
三、资金占用和对控股股东、实际控制人的担保情况	错误！未定义书签。
四、同业竞争	错误！未定义书签。
五、关联交易	错误！未定义书签。
第七节 本次募集资金运用	122
一、本次募集资金投资项目计划	122
二、本次募集资金投资项目的具体情况	123
三、本次募集资金用于研发投入的情况	128
四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务	129
五、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响	130
六、公司主营业务及募投项目符合国家产业政策	131
七、公司具有“轻资产、高研发投入”的特点	133
第八节 历次募集资金运用	错误！未定义书签。
一、最近五年内募集资金基本情况	错误！未定义书签。
二、前次募集资金实际使用情况	错误！未定义书签。
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用	错误！未定义书签。
第九节 声明	错误！未定义书签。
一、发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明	错误！未定义书签。
一、发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明	错误！未定义书签。
一、发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明	错误！未定义书签。
二、发行人控股股东声明	错误！未定义书签。
三、保荐人（主承销商）声明	错误！未定义书签。
四、发行人律师声明	错误！未定义书签。
五、会计师事务所声明	错误！未定义书签。
六、资信评级机构	错误！未定义书签。

七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺	错误！未定义书签。
第十节 备查文件	135
附表一：发行人及其子公司拥有的境内专利	错误！未定义书签。
附表二：发行人及其子公司拥有的境外专利	错误！未定义书签。
附表三：发行人及其子公司拥有的境内注册商标	错误！未定义书签。
附表四：发行人及其子公司拥有的境外注册商标	错误！未定义书签。
附表五：发行人及其子公司拥有的软件著作权	错误！未定义书签。
附表六：发行人及其子公司拥有的域名	错误！未定义书签。
附表七 债券持有人会议规则主要内容	错误！未定义书签。
一、债券持有人行使权利的形式	错误！未定义书签。
二、债券持有人会议规则的主要条款	错误！未定义书签。

第一节 释义

本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一、一般释义		
公司、本公司、发行人、华峰测控	指	北京华峰测控技术股份有限公司
华峰有限	指	北京华峰测控技术有限公司，系北京华峰测控技术股份有限公司前身
华峰技术	指	北京市华峰测控技术公司，系北京华峰测控技术有限公司前身
天津华峰	指	华峰测控技术（天津）有限责任公司，系公司全资子公司
盛态思	指	盛态思软件（天津）有限责任公司（曾用名：北京盛态思软件有限公司），系公司全资子公司，报告期内已注销
华峰装备	指	北京华峰装备技术有限公司，系公司全资子公司
爱格测试	指	爱格测试技术有限公司，系公司在中国香港特别行政区的全资子公司
美国爱格	指	爱格测试技术（美国）股份公司，ACCOTEST TECHNOLOGY (USA),INC，系公司在美国的全资子公司
马来西亚爱格技术	指	爱格测试技术（马来西亚）有限公司，ACCOTEST TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD，系公司在马来西亚的全资子公司
马来西亚爱格电子	指	爱格测试电子（马来西亚）有限公司，ACCOTEST ELECTRONICS (MALAYSIA)SDN.BHD，系公司在马来西亚的全资子公司
日本爱格	指	爱格测试技术（日本）股份公司，Acco TEST Technology Japan 株式会社，曾用名株式会社マクレン，系公司在日本的全资子公司
福州华峰	指	系公司在境内福州市的控股子公司
上海华峰	指	系公司在境内上海市的控股子公司
新加坡华峰	指	系公司在新加坡的控股子公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
科天半导体	指	KLA Corporation
泰瑞达	指	Teradyne Inc.
爱德万	指	Advantest Corporation
科休	指	Cohu, Inc.
长川科技	指	杭州长川科技股份有限公司
联动科技	指	佛山市联动科技股份有限公司
意法半导体	指	ST Microelectronics N.V.

安森美	指	ON Semiconductor Corporation
安世半导体	指	Nexperia B.V.
可转债	指	可转换公司债券
本次可转债	指	北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
本次发行	指	本公司拟向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币74,947.50万元的行为
尽职调查报告	指	《中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》
律师工作报告	指	《北京德和衡律师事务所关于北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》
法律意见书	指	《北京德和衡律师事务所关于北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》及其补充法律意见书
本次募集资金投资项目、募投项目	指	基于自研ASIC芯片测试系统的研发创新项目
芯华控股	指	天津芯华投资控股有限公司（曾用名：北京芯华投资控股有限公司）
时代远望	指	中国时代远望科技有限公司
深圳芯瑞	指	深圳芯瑞创业投资合伙企业（有限合伙）
上海惠适	指	上海惠适电子有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐人、主承销商、受托管理人、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
发行人律师、德和衡律师事务所	指	北京德和衡律师事务所
审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、首席技术专家
《审计报告》	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第3-00293号北京华峰测控技术股份有限公司2023年度的审计报告、大信审字[2025]第3-00109号北京华峰测控技术股份有限公司2024年度的审计报告和大信审字[2026]第3-00310号北京华峰测控技术股份有限公司2025年度的审计报告
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京华峰测控技术股份有限公司章程》
募集说明书、本募集说明书	指	《北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
股东大会	指	北京华峰测控技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京华峰测控技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京华峰测控技术股份有限公司监事会

报告期各期末	指	2023年12月31日、2024年12月31日和2025年12月31日
报告期	指	2023年度、2024年度和2025年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、专业释义		
ATE	指	Automatic Test Equipment的缩写，即半导体自动化测试机或测试系统
频率	指	在固定的时间可以传输的资料数量，亦即在传输管道中可以传递数据的能力
占空比	指	在一个脉冲循环中，通电时间相对于总时间所占的比例
良率	指	被测试电路经过全部测试流程后，测试结果为良品的电路数量占据全部被测试电路数量的比例
集成电路、芯片、IC	指	按照特定电路设计，通过特定的集成电路加工工艺，将电路中所需的晶体管、电感、电阻和电容等元件集成于一小块半导体（如硅、锗等）晶片或介质基片上的具有所需电路功能的微型结构
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，又称Wafer、圆片，在硅晶片上可加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品
分选机	指	根据集成电路不同的性质，对其进行分级筛选的设备
探针台	指	将晶圆逐片自动传送至测试位置，芯片的管脚通过探针、专用连接线与测试机的功能模块进行连接的设备
数字集成电路	指	基于数字逻辑设计和运行的，用于处理数字信号的集成电路，包括微元件，存储器和逻辑芯片
模拟集成电路	指	处理连续性模拟信号的集成电路芯片。电学上的模拟信号是指用电参数，如电流和电压，来模拟其他自然物理量而形成的连续性的电信号
引脚、管脚	指	从芯片内部电路引出与外围电路的接线，所有的引脚构成该块芯片的接口
分立器件	指	单一封装的半导体组件，具备电子特性功能，常见的分立式半导体器件有二极管、三极管、光电器件等
智能功率模块	指	由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成的集成电路模块。该模块不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起，而且其内部还集成过电压、过电流和过热等故障检测电路，并可将检测信号送到CPU
CPU	指	Central Processing Unit的缩写，中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是电子产品的运算核心和控制核心
V/I源	指	电压/电流源
MOSFET	指	Metal-Oxide -Semiconductor Field Effect Transistor的缩写，金属一氧化物半导体场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效应晶体管
PMIC	指	Power Management IC的缩写，电源管理类集成电路
雪崩、UIS	指	Unclamped inductive switching的缩写，向半导体的接合部施加较大的反向衰减偏压时，电场衰减电流的流动会引起雪崩衰减。此时元件可吸收的能量称为雪崩耐量，表示施加电压时的抗击穿性
电平	指	两功率或电压之比的对数，有时也可用来表示两电流之比的对数
运算放大器	指	具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中，通常结合反馈网络共同组成某种信号，是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果

PCB	指	Printed Circuit Board 的缩写，印制电路板
FPGA	指	Field-Programmable Gate Array的缩写，即现场可编程门矩阵
继电器	指	当输入量（激励量）的变化达到规定要求时，在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电控制器件
先进封装	指	最新的封装技术，例如2.5D及3D芯片技术、晶圆级封装、倒装芯片封装和硅通孔技术等
功放	指	功率放大器，在给定失真率条件下，能产生最大功率输出以驱动某一负载的放大器，包括AB、D、数字功放。其中AB类功放通过晶体管放大电流从而放大信号，D类功放用脉冲宽度对模拟音频幅度进行模拟，数字类功放用数字信号进行功率放大
IDM	指	垂直整合模式，该模式下企业能够独立完成芯片设计、晶圆制造、封装测试的所有环节
总谐波失真	指	输出信号比输入信号多出的谐波成分
SoC	指	System-on-Chip的缩写，即系统级芯片，是在单个芯片上集成多个具有特定功能的集成电路所形成的电子系统
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit的简称，是一种为专门目的而设计的集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor的缩写，绝缘栅双极型晶体管。该晶体管同时具备MOSFET和双极性晶体管的优点，如输入阻抗高、易于驱动、电流能力强、功率控制能力高、工作频率高等特点
KGD	指	Known Good Die的简称，即已知合格芯片，代表经过晶圆测试后检验合格的裸片
宽禁带半导体	指	禁带宽度在2.3eV及以上的半导体材料，禁带宽度指导带的最低能级和价带的最高能级之间的能量差，主要包括碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等
氮化镓、GaN	指	Gallium Nitride，氮和镓的化合物，一种第三代半导体，主要应用在半导体照明和显示、电力电子器件、激光器和探测器等领域

注：本募集说明书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致；本募集说明书中第三方数据不存在专门为本次发行准备的情形，发行人不存在为此支付费用或提供帮助的情形。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

中文名称：北京华峰测控技术股份有限公司

英文名称：Beijing Huafeng Test & Control Technology Co., Ltd.

注册地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼1至5层101、102、103

通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼1至5层101、102、103

法定代表人：孙镪

注册资本：13,553.3225 万元

有限责任公司设立时间：1999 年 9 月 1 日

股份有限公司设立时间：2017 年 12 月 11 日

邮政编码：100094

电话号码：010-6372 5600

传真号码：010-6372 5652

互联网网址：www.hftc.com.cn

电子信箱：ir@accotest.com

股票简称：华峰测控

股票代码：688200.SH

股票上市交易所：上海证券交易所

统一社会信用代码：91110108102002226D

经营范围：电子产品、仪器仪表、机械自动控制设备的制造（限分支机构经营）；技术开发、技术服务；销售自行开发后的产品；技术进出口、货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、本次发行的背景和目的

（一）本次向不特定对象发行的背景

1、半导体设备行业高速发展

全球半导体行业在过去几年中保持了持续增长的态势。特别是在 5G、物联网、人工智能、新能源汽车等新兴领域的推动下，市场对高性能、高可靠性的半导体产品需求日益增加。在市场需求与政策支持的双重驱动下，半导体设备行业发展迅猛。据国际半导体产业协会（SEMI）数据显示，2025 年全球半导体设备市场规模同比增长 13.7%，达到 1,330 亿美元，受益于 AI 需求扩大，预计 2026 年、2027 年将分别达到 1,450 亿美元和 1,560 亿美元。

随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，半导体设备市场需求将持续增长。国家也将持续加大政策支持力度，推动半导体设备行业向高端化、智能化、自主化方向迈进，提升我国半导体产业在全球的竞争力。

2、国产替代趋势明显，政策支持显著

近年来，国家高度重视半导体产业发展，大力出台了一系列力度空前的政策，为行业发展注入强大动力。如《国家集成电路产业发展推进纲要》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等，从财税、投融资、研究开发等八个方面给予全方位支持，对符合条件的集成电路生产企业、设计企业等给予不同程度的企业所得税减免，鼓励企业加大研发投入。

在进出口政策上，对特定的集成电路生产企业进口自用生产性原材料、消耗品，以及重点集成电路设计企业和软件企业进口自用设备等，免征进口关税，降低企业生产成本。同时，通过国家重点研发计划、国家科技重大专项等给予半导体关键核心技术研发支持，探索构建关键核心技术攻关新型举国体制。

上述政策为国内企业提供了有力的政策支持和广阔的市场机遇。随着国际贸易环境的变化，美国对半导体成品加征关税的威胁加剧，全球供应链稳定性受到冲击，国内企业对半导体设备的自主可控需求日益迫切，高端测试设备领域国产化替代的需求尤为显著。

（二）本次向不特定对象发行的目的

华峰测控专注于半导体测试系统的研发、生产及销售，作为国内具有竞争优势的半导体测试系统供应商，产品涵盖了 SoC 测试系统、模拟及混合信号测试系统、功率器件测试系统等，广泛应用于集成电路设计、制造、封装测试等环节，为国内众多半导体企业提供关键的测试解决方案，在国内半导体测试系统市场占据重要地位。

本次可转换债券的发行紧密结合行业发展现状与趋势，精准对接华峰测控的未来发展战略，募集资金将投向“基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目”。公司将构建长期稳定和可靠的测试系统核心 ASIC 供应链，打造全新一代基于自研 ASIC 芯片的国产化测试系统，减少对外部专用芯片供应商资源的依赖，提升公司核心竞争力。

三、本次发行的基本情况

（一）本次发行的证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行规模和发行数量

本次发行可转债募集资金总额为人民币 74,947.50 万元，发行数量为 7,494,750 张，749,475 手。

（三）票面金额和发行价格

本次可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 74,947.50 万元（含 74,947.50 万元），募集资金净额将扣除发行费用后确定。

（五）募集资金专项存储的账户

公司已经制定募集资金使用管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（六）募集资金投向

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 74,947.50 万元（含 74,947.50 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目	75,888.00	74,947.50
	合计	75,888.00	74,947.50

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

（七）发行方式与发行对象

本次发行向股权登记日（2026 年 6 月 22 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 74,947.50 万元的部分由主承销商包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为 1 手（1,000 元），上限为 1,000 手（100 万元）。

1、向发行人原股东优先配售

原股东可优先配售的华峰转债数量为其在股权登记日（2026 年 6 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的持有华峰测控的股份数量按每股配售 3.737 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.003737 手可转债。

发行人现有总股本 200,575,083 股，剔除公司回购专户库存股 110,400 股后，可参与原股东优先配售的股本总额为 200,464,683 股。按本次发行优先配售比例计算，原股

东可优先认购的可转债上限总额为 749,336 手。

公司原股东（含有限售条件股东）的优先认购通过上交所交易系统进行，优先认购时间为 T 日（9:30-11:30，13:00-15:00），配售代码为“726200”，配售简称为“华峰配债”。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。

原股东除可参加优先配售外，还可在 T 日通过上交所交易系统参加优先配售后余额的申购。

2、网上发行

社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“718200”，申购简称为“华峰发债”。每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（100 万元），如超过则该笔申购无效。

申购时，投资者无需缴付申购资金。

参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人与主承销商将协商是否中止本次发行，如果中止发行，将及时向上交所报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后，发行人、主承销商按照以下原则配售可转债：

当网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，按投资者的有效申购量配售。

当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定

发售结果。2026年6月24日（T+1日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由发行人与主承销商共同组织摇号抽签。

中签率=（最终确定的网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

2026年6月23日（T日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所根据实际有效申购进行申购配号，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号，并将配号结果传到各证券交易网点。

2026年6月24日（T+1日），向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。发行人与主承销商将公告本次发行的网上中签率。

2026年6月24日（T+1日）在公证部门公证下，由发行人、主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。

2026年6月25日（T+2日），发行人与主承销商将公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购华峰转债的数量并准备认购资金，每一中签号码认购1手（10张，1,000元）。

2026年6月25日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

（八）向原股东配售的安排

原股东可优先配售的华峰转债数量为其在股权登记日（2026年6月22日，T-1日）收市后登记在册的持有华峰测控的股份数量按每股配售3.737元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.003737手可转债。

发行人现有总股本200,575,083股，剔除公司回购专户库存股110,400股后，可参与原股东优先配售的股本总额为200,464,683股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为749,336手。

公司原股东（含有限售条件股东）的优先认购通过上交所交易系统进行，优先认购时间为T日（9:30-11:30，13:00-15:00），配售代码为“726200”，配售简称为“华峰配债”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整。原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。

原股东除可参加优先配售外，还可在T日通过上交所交易系统参加优先配售后余额的申购。

（九）承销方式及承销期

承销方式：本次发行由中金公司承销，本次发行认购金额不足74,947.50万元的部分由主承销商余额包销。包销基数74,947.50万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%，即原则上最大包销金额为22,484.25万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行政程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

承销期：本次可转债发行的承销期为2026年6月18日至2026年6月29日。

（十）发行费用

本次发行费用总额预计为1,045.62万元，具体包括：

单位：万元

项目	金额
承销保荐费用	820.16

项目	金额
律师费用	84.91
审计及验资费用	63.92
资信评级费用	18.87
信息披露及发行手续等费用	57.76
合计	1,045.62

注：1、以上金额均为不含税金额；2、各项费用根据发行结果可能会有调整；3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

（十一）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

本次可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的主要日程安排如下表所示：

日期	发行安排
2026年6月18日（T-2）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
2026年6月22日（T-1）	网上路演；原股东优先配售股权登记日
2026年6月23日（T）	刊登发行提示性公告；原股东优先配售认购日；网上、网下申购日
2026年6月24日（T+1）	刊登网上中签率及网下发行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签
2026年6月25日（T+2）	刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果缴款；网下投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分别验资
2026年6月26日（T+3）	根据网上网下资金到账情况确认最终配售结果
2026年6月29日（T+4）	刊登发行结果公告

以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。

本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。

（十二）本次发行证券的上市流通

本次发行结束后，公司将尽快办理本次可转债在上交所挂牌上市交易，具体上市时间将另行公告。

（十三）投资者持有期的限制或承诺

本次可转债上市流通，所有投资者均无持有期限限制。

（十四）本次可转债基本发行条款

1、债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2026 年 6 月 23 日至 2032 年 6 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

2、票面金额和发行价格

本次可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

3、债券利率

第一年 0.1%、第二年 0.3%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

4、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026 年 6 月 29 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2026 年 12 月 29 日）起至可转债到期日（2032 年 6 月 22 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

5、评级情况

本次可转债经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《2026 年北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：CCXI-20250988D-03），本次可转债信用等级为 AAstī，华峰测控主体信用等级为 AAstī，评级展望稳定。

本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将对本次可转债的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

6、债券持有人会议相关事项

（1）可转债持有人的权利

- 1) 根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- 2) 根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- 3) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- 4) 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- 5) 按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- 6) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- 7) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 可转债持有人的义务

- 1) 遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
- 2) 依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
- 3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- 4) 除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- 5) 法律法规及《公司章程》规定应当由债券持有人承担的其他义务。

(3) 在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- 1) 公司拟变更《募集说明书》的约定；
- 2) 拟修改债券持有人会议规则；
- 3) 拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
- 4) 公司已经或者预计不能按期支付本次可转债本息；
- 5) 公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可

能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

- 6) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
- 7) 公司提出债务重组方案；
- 8) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性；
- 9) 保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

10) 公司、单独或者合计持有本次可转债总额 10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开；

11) 《募集说明书》约定的其他应当召开债券持有人会议的情形；

12) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

13) 出现根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及《债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

(4) 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

- 1) 公司董事会；
- 2) 单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人；
- 3) 债券受托管理人；
- 4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

7、转股价格的确定及其调整

(1) 初始转股价格的确定依据

初始转股价格：336.12 元/股，不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总

额/该日公司股票交易总量。

(2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

8、转股价格向下修正条款

(1) 修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交

公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

（2）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

9、转股数量确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

Q：指可转债持有人申请转股的数量；

V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P 为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及对应的当期应计利息。

10、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的 110%（含

最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

(2) 有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%), 公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为: $IA = B \times i \times t / 365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i: 指本次可转债当年票面利率;

t: 指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外,当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司董事会会有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

11、回售条款

(1) 有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见第 10 条赎回条款的相关内容。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

12、还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2026年6月23日，T日）。

②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日

之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

13、构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

（1）债券违约情形

以下事件构成本次可转债项下的违约事件：

- 1) 发行人已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；
- 2) 发行人已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债，未偿金额超过 2,000 万元，且可能导致本次可转债发生违约的；
- 3) 发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 5%以上的子公司，及本募集说明书披露的重要子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 2,000 万元，且可能导致本次债券发生违约的；
- 4) 发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证且导致发行人偿债能力面临严重不确定性的，或其被托管/接管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
- 5) 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
- 6) 发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
- 7) 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化的；
- 8) 本次可转债存续期内，发行人违反《受托管理协议》项下的陈述与保证、未能按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务等义务与职责以致对发行人对本次可转债

的还本付息能力产生重大不利影响，且一直持续二十（20）个连续工作日仍未得到纠正；

9）发行人发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

（2）针对公司违约的违约责任及其承担方式

发行人保证按照本次可转债发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本次可转债利息及兑付本次可转债本金，若不能按时支付本次可转债利息或本次可转债到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次可转债票面利率上浮百分之二十（20%）。

当发行人未按时支付本次可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人将依据相应约定在必要时根据债券持有人会议的授权，代表债券持有人提起、参加民事诉讼或参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。

（3）争议解决方式

受托管理协议项下所产生的或与受托管理协议有关的任何争议，双方均有权向北京市海淀区人民法院提起诉讼解决。

14、转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

15、担保事项

本次可转债不提供担保。

16、本次发行方案的有效期限

公司本次可转债方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

四、本次发行有关机构

（一）发行人：北京华峰测控技术股份有限公司

法定代表人：孙镪

联系人：孙镗、魏文渊

办公地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼1至5层101、102、103

电话：010-6372 5600

传真：010-6372 5652

(二) 保荐人、主承销商、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

保荐代表人：高楚寒、贾义真

项目协办人：罗翔

项目组成员：李晓晨、李冰、金楨栋、赵天浩、王敏知、吴昕桓

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

(三) 发行人律师：北京德和衡律师事务所

负责人：孙晶

经办律师：郭恩颖、王智

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心C座12层

电话：010-8540 7666

传真：010-8540 7608

(四) 审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：谢泽敏

经办注册会计师：张希海、肖富建、王文杰

办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

电话：010-82330558

传真：010-82327668

(五) 资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

法定代表人：岳志岗

经办人员：汤梦琳、郑皓月

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 5 号楼

电话：010-66428877

传真：010-66426100

(六) 收款银行：招商银行股份有限公司

账号名称：北京华峰测控技术股份有限公司

账号：110939178410001

开户行：招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行

(七) 申请上市的交易所：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号

电话：021-6880 8888

传真：021-6880 4868

(八) 证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

电话：021-6887 0204

传真：021-5889 9400

五、发行人与本次发行相关机构的关系

截至 2025 年 12 月 31 日，保荐人、主承销商和受托管理人中金公司及其子公司持有发行人 255,394 股，合计占发行人总股本的 0.19%。保荐人已建立并执行严格的信息隔离墙制度，上述情形不会影响保荐人正常履行保荐及承销职责。

除前述情形外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负

责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

第三节 发行人基本情况

一、发行人股本结构及前十名股东持股情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人总股本为 135,533,225 股，股本结构如下：

股份类别	股数（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股	-	0.00
无限售条件流通股	135,533,225	100.00
股份总数	135,533,225	100.00

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例	持有有限售条件股份数量（股）	质押股份数量（股）	股东性质
1	芯华控股	34,526,420	25.47%	-	-	境内非国有法人
2	时代远望	14,802,192	10.92%	-	-	国有法人
3	香港中央结算有限公司	11,314,075	8.35%	-	-	其他
4	王皓	3,717,249	2.74%	-	-	境内自然人
5	深圳芯瑞	3,669,401	2.71%	-	-	境内非国有法人
6	李寅	3,070,000	2.27%	-	-	境内自然人
7	中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,153,741	1.59%	-	-	其他
8	交通银行股份有限公司—易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	1,624,673	1.20%	-	-	其他
9	陈爱华	1,500,696	1.11%	-	-	境内自然人
10	中国银行—易方达积极成长证券投资基金	1,452,469	1.07%	-	-	其他

二、科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施

（一）公司科技创新水平

自成立以来，公司始终专注于半导体自动化测试系统领域，以自主研发的产品实现

了模拟及混合信号类半导体自动化测试系统的进口替代，同时不断拓展在氮化镓、碳化硅以及 IGBT 等功率分立器件和功率模块类半导体测试领域的覆盖范围。2023 年，公司推出了面向 SoC 测试领域的全新一代测试系统 STS8600，该测试系统拥有更多的测试通道数以及更高的测试频率，进一步完善了公司的产品线，拓宽了公司产品的可测试范围，为公司未来的长期发展提供了强大的助力。

半导体自动化测试设备属于专用设备制造行业，贯穿半导体行业从设计到封测的主要产业环节，行业技术水平与 IC、分立器件和功率模块等技术发展密切相关。公司拥有模拟、数模混合、SoC、分立器件、功率模块等测试领域的诸多核心技术，包括 VI 源、精密电压电流测量、宽禁带半导体测试和智能功率模块测试等，同时密切跟踪半导体行业的发展方向，不断为客户推出功能更全、精度更高、速度更快的测试设备。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已获得授权且尚在有效期内的境内外专利共 236 项，其中包括 75 项发明专利、145 项实用新型专利和 16 项外观设计专利。公司先后承担了多个国家重大科技专项，深度参与了高端模拟/混合电路测试系统的研发和产业化工作。

公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业、北京市隐形冠军、2021 年“中国芯”优秀支撑服务企业、天津市科技领军培育企业等多项荣誉，整体科技创新实力及技术水平有较好的市场竞争力。

（二）保持科技创新能力的机制或措施

1、强化知识产权管理

公司坚持自主研发、持续创新，注重知识产权保护，制定了知识产权管理的制度。公司对行业内专利情况进行定期追踪和分析，在研发工作开展前进行专利检索，规避现有专利，了解技术发展动向，制定公司知识产权路线图和目标。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已获得授权且尚在有效期内的境内外专利共 236 项，其中包括 75 项发明专利、145 项实用新型专利和 16 项外观设计专利。随着核心技术的不断迭代和创新，公司也将做好核心技术的专利保护工作，提高核心竞争力。

（1）制定知识产权相关制度和流程

公司建立了较为完善的知识产权管理制度和流程，包括《专利管理办法》和《研发管理制度》等。公司不断加强对技术秘密和核心技术保护力度，及时确认发明人的成果，

适时将内部专利转化为外部专利申请。公司高度重视知识产权保护，将其深度融入研发流程，在研发全程明确要求开展专利挖掘。在绩效考核体系中，给研发人员增设专利相关指标并提升权重，激励其主动挖掘、申请专利。同时秉持开放理念，非研发部门员工也享有专利申请权，不论身处何部门，只要有可申请专利的创新成果，均可按流程提交申请，为公司知识产权积累贡献力量。

（2）建立知识产权管理机制

公司首席技术专家负责公司整体知识产权工作，并设置知识产权专员，处理知识产权日常事务，包括专利初步检索、研发流程跟踪、与专利代理沟通、组织专利选题审核等工作。同时，公司还设有跨部门的知识产权小组，负责专利选题审核。

2、构建创新激励机制

在创新萌芽阶段，公司针对研发人员的发明构思建立了奖励制度，并承接部分发明构思作为专利备选题目；在创新完成阶段，公司除按照相关法规的要求对职务发明人进行奖励外，还制定了额外的奖励措施和较高的奖励标准。每年年末，公司为本年度专利成果最优秀的员工设置了“专利达人奖”。此外，公司为鼓励技术人员“追求极致”的技术精神，设立了“华峰技术卓越奖”专项奖项，对技术创新能力成长突出的技术人员进行奖励。

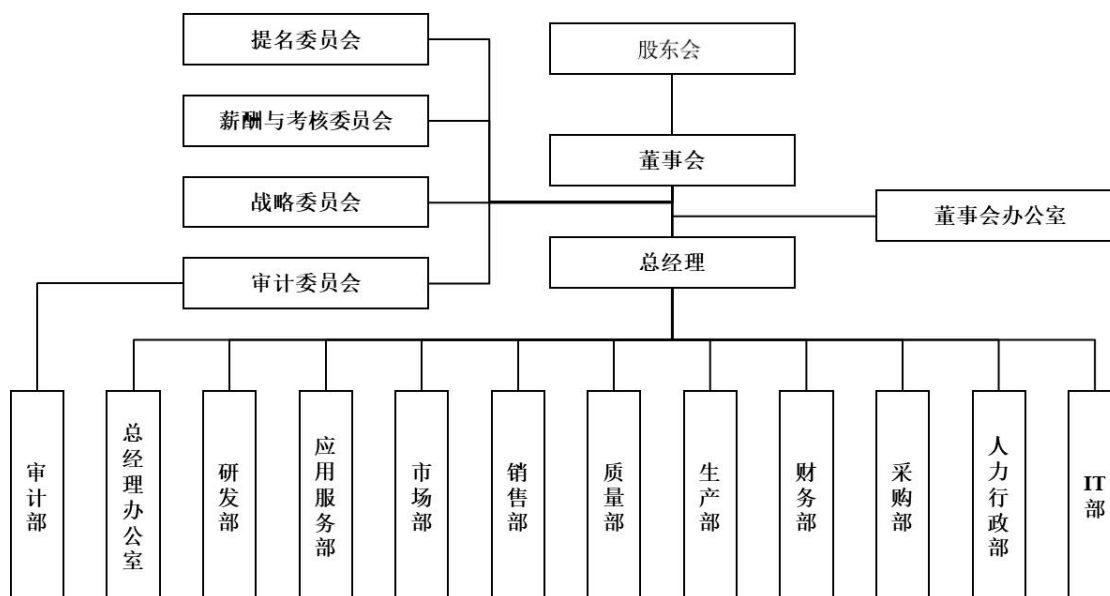
3、完善技术创新氛围

公司大力倡导“开放分享”的研发文化，全力打造创新交流环境。对于员工的技术研发成果，支持申请专利，鼓励向专业刊物投稿论文，提升公司业内影响力。同时，积极推动内部知识传承，鼓励技术人员总结研发经验，形成内部技术论文，经审核后收录成册，在公司内刊发表，助力员工实现技术能力的共同提升。

三、公司组织结构及重要权益投资情况

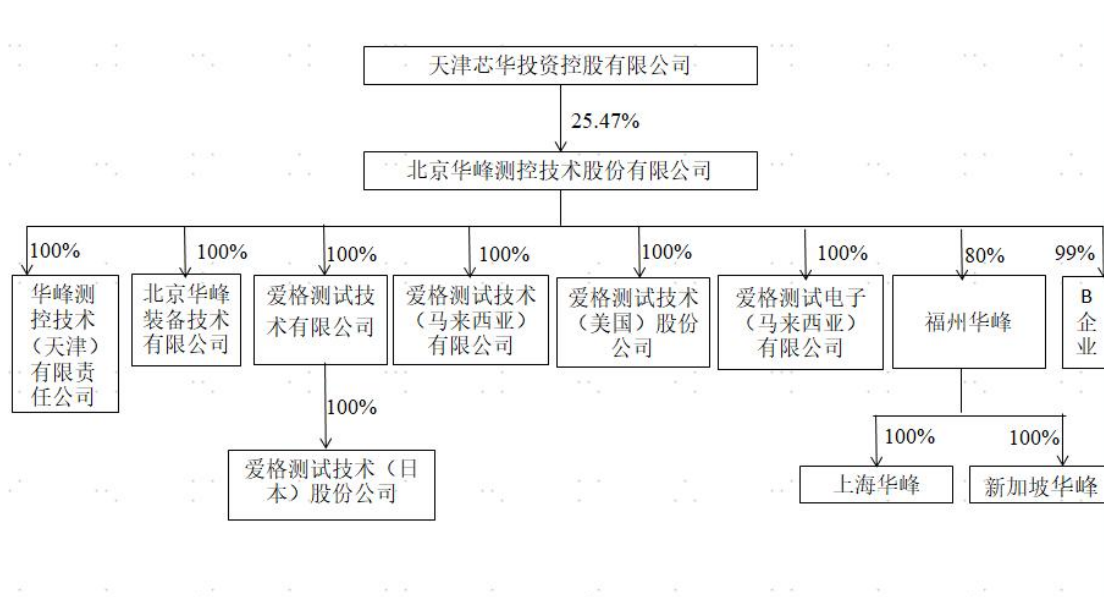
（一）公司的组织结构

截至本募集说明书签署日，发行人组织结构情况如下：



（二）公司的对外投资情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人对重要子公司及其他一级子公司的持股架构图如下：



注：福州华峰、上海华峰、新加坡华峰已纳入合并报表范围，工商变更尚未完成。

1、重要子公司概况

截至募集说明书出具日，发行人重要子公司基本情况如下：

序号	企业名称	持股比例/拥有权益的比例	成立日期	注册资本	主要生产经营地	经营范围/主营业务
1	天津华峰	100%	2017-08-15	8,000 万元	天津	电子产品及配件、机械自动控制设备的技术开发、技术服务；电子产品、仪器仪表、机械自动控制设备的制造；电子产品、仪器仪表、机械自动控制设备批发兼零售/销售；自营和代理货物及技术的进出口；集成电路测试设备的技术进出口。
2	华峰装备	100%	2021-02-26	1,000 万元	北京	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；仪器仪表制造；集成电路设计；专用仪器制造；仪器仪表销售；软件销售；仪器仪表修理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发。
3	爱格测试	100%	2017-09-01	1 万港元	中国香港	科技技术推广及进出口贸易
4	马来西亚爱格技术	100%	2021-11-22	127.4265 万马来西亚令吉	马来西亚	工程与技术的研究与开发；技术测试与分析；测量、测试、导航与控制设备的进出口
5	美国爱格	100%	2022-11-15	50 万美元	美国	售后服务和支持
6	马来西亚爱格电子	100%	2023-10-03	278.3955 万马来西亚令吉	马来西亚	制造和组装半导体测试设备及零部件
7	日本爱格	100%	2003-06-12	300 万日元	日本	二手半导体制造装置及二手半导体测试装置等的进出口销售业务；半导体制造装置、半导体测试装置及测量仪器等的翻译业务；基于劳动者派遣事业法的一般和特定劳动者派遣业务；与上述各项业务相关的所有附带业务

(1) 天津华峰

名称	华峰测控技术（天津）有限责任公司
统一社会信用代码	91120116MA05UG3U3Q
住所	天津市滨海新区中新天津生态城川博道 1201 号
主要生产经营地	天津市滨海新区中新天津生态城川博道 1201 号
法定代表人	蔡琳
注册资本	8,000 万元人民币
成立日期	2017 年 8 月 15 日

经营范围/主要业务	电子产品及配件、机械自动控制设备的技术开发、技术服务；电子产品、仪器仪表、机械自动控制设备的制造；电子产品、仪器仪表、机械自动控制设备批发兼零售/销售；自营和代理货物及技术的进出口；集成电路测试设备的技术进出口
经营期限	2017年8月15日至无固定期限
持股情况	发行人持股100%，为发行人的控股子公司

(2) 华峰装备

名称	北京华峰装备技术有限公司
统一社会信用代码	91110116MA020HEK8Q
住所	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（集群注册）
法定代表人	孙镗
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2021年2月26日
经营范围/主要业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；仪器仪表制造；集成电路设计；专用仪器制造；仪器仪表销售；软件销售；仪器仪表修理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发
经营期限	2021年2月26日至无固定期限
持股情况	发行人持股100%，为发行人的控股子公司

(3) 爱格测试

名称	爱格测试技术有限公司
商业登记号码	68135015
注册编号	2573004
注册办事处地址	中国香港九龙观塘开源道45号有利中心3楼60室
注册资本	1万港元
成立日期	2017年9月1日
经营范围/主要业务	科技技术推广及进出口贸易
持股情况	发行人持股100%，为发行人的控股子公司

(4) 马来西亚爱格技术

名称	ACCOTEST TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.
----	---

公司注册号	202101039123 (1439423-T)
注册地址	Level 11, Menara LGB 1, Jalan Wan Kadir, Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur, W.P. Kuala Lumpur
注册资本	127.4265 万马来西亚令吉
成立日期	2021 年 11 月 22 日
经营范围/主要业务	工程与技术的研究与开发；技术测试与分析；测量、测试、导航与控制设备的进出口
持股情况	发行人持股 100%，为发行人的控股子公司

(5) 美国爱格

名称	ACCOTEST TECHNOLOGY (USA),INC
注册地址	556 N Diamond Bar Blvd, STE 213, Diamond Bar, CA 91765, USA
注册资本	50 万美元
成立日期	2022 年 11 月 15 日
经营范围/主要业务	售后服务和支持
持股情况	发行人持股 100%，为发行人的控股子公司

(6) 马来西亚爱格电子

名称	ACCOTEST ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN.BHD.
公司注册号	202301038761 (1532682-M)
注册地址	Level 11, Menara LGB 1, Jalan Wan Kadir, Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur, W.P. Kuala Lumpur
注册资本	278.3955 万马来西亚令吉
成立日期	2023 年 10 月 3 日
经营范围/主要业务	制造和组装半导体测试设备及零部件
持股情况	发行人持股 100%，为发行人的控股子公司

(7) 日本爱格

名称	AccoTEST Technology Japan 株式会社
注册编码	0116-02-021135
注册地址	東京都杉並区松庵 3 丁目 20 番 11 号グレイス松庵 601 号

注册资本	300 万日元
成立日期	2003 年 6 月 12 日
经营范围/主要业务	二手半导体制造装置及二手半导体测试装置等的进出口销售业务；半导体制造装置、半导体测试装置及测量仪器等的翻译业务；基于劳动者派遣事业法的一般和特定劳动者派遣业务；与上述各项业务相关的所有附带业务
持股情况	爱格测试持股 100%，为发行人的控股子公司

注：日本爱格系 2024 年 4 月 1 日因现金收购纳入合并范围，该次收购不构成重大资产重组

2、重要子公司最近一年主要财务数据

发行人重要子公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

序号	子公司	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	天津华峰	96,713.93	85,766.84	70,348.36	23,932.81
2	华峰装备	4,745.41	3,689.61	4,498.68	666.28
3	爱格测试	645.57	461.10	1,320.45	203.44
4	马来西亚爱格技术	889.72	665.13	1,835.90	104.89
5	美国爱格	485.83	462.16	814.26	-31.02
6	马来西亚爱格电子	1,410.47	630.54	1,125.16	273.58
7	日本爱格	179.53	96.53	691.72	16.90

注 1：上述财务数据均为单体口径；

注 2：日本爱格系爱格测试子公司；

注 3：上述财务数据已按照企业会计准则的规定编制，并包含在公司经审计的合并财务报表中；

注 4：上述重要子公司包括了单体口径总资产、净资产、营业收入、净利润任意指标占发行人合并报表对应财务数据 5%以上的子公司，以及出于实质重于形式角度，虽财务指标占比未达到上述要求，但对发行人业务发展具有重要影响的子公司。

3、参股公司情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人投资参股 8 家企业。截至募集说明书出具日，发行人参股公司基本情况如下：

序号	企业名称	持股比例/ 出资比例	成立 日期	注册资本/出 资金额(万元)	认缴出资额/ 持有股数(万 元/万股)	注册地址/ 主要经营 场所	经营范围/主营业务
1	南京武岳峰汇 芯创业投资合 伙企业(有限	20%	2021-12-28	25,000	5,000	南京市浦 口区浦口 经济开发	一般项目：创业投资(限 投资未上市企业)；以 自有资金从事投资活动

序号	企业名称	持股比例/ 出资比例	成立 日期	注册资本/出 资金额(万元)	认缴出资额/ 持有股数(万 元/万股)	注册地址/ 主要经营 场所	经营范围/主营业务
	合伙)					区双峰路 69号B-65	
2	上海韬盛电子 科技股份有限公司	2.1876%	2007-04-19	3,279.9273	71.75	中国(上 海)自由贸 易试验区 郭守敬路 498号1幢 201/02,20 1/04,201/0 6室	电子测量软件开发和销售, 电子测量仪器仪表的销售, 测试设备的研发、生产及销售, 集成电路的制造, 精密模具的设计、销售, 从事货物与技术的进出口业务, 并提供相关的技术咨询和技术服务
3	成都中科四点 零科技有限 公司	10.8392%	2018-09-03	734.775157	79.643392	中国(四 川)自由 贸易试验 区成都高 新区益州 大道中段 1800号1 栋19层 1903室	一般项目: 软件开发; 软件销售; 通信设备销售; 电子产品销售; 仪器仪表销售; 集成电路设计; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电子测量仪器制造【分支机构经营】; 其他通用仪器制造【分支机构经营】; 专用仪器制造【分支机构经营】
4	合肥启航恒鑫 投资基金合伙 企业 (有限合伙)	3.9124%	2024-01-17	127,800	5,000	安徽省合 肥市经济 技术开发 区清潭路 693号中 德合作创 业园9号 楼808室	一般项目: 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动); 创业投资(限投资未上市企业); 以自有资金从事投资活动
5	苏州联讯仪器 股份有限公司	1.8427%	2017-03-15	10,266.6667	189.189	苏州高新 区湘江路 1508号5 幢	一般项目: 仪器仪表制造; 光学仪器制造; 通信设备制造; 光通信设备制造; 智能仪器仪表制造; 半导体器件专用设备制造; 电子测量仪器制造; 实验分析仪器制造; 机械零件、零部件加工; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械设备研发; 工程和技术研究和试验发展; 5G 通信技术服务; 软件开发; 仪器仪

序号	企业名称	持股比例/ 出资比例	成立 日期	注册资本/出 资金额(万元)	认缴出资额/ 持有股数(万 元/万股)	注册地址/ 主要经营 场所	经营范围/主营业务
							表修理；仪器仪表销售；光学仪器销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；光通信设备销售；电子产品销售；软件销售；半导体器件专用设备销售；电子测量仪器销售；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）
6	广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）	2.346%	2021-10-28	213,131.3131	5,000	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C013090	创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
7	江苏芯长征微电子集团股份有限公司	0.7489%	2017-03-17	41,779.5533	312.8823	南京市江宁开发区苏源大道62号1106-3室（江宁开发区）	一般项目：集成电路设计；电子元器件制造；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；信息系统集成服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理
8	北京士模微电子有限责任公司	0.436%	2021-01-18	2,054.70825	8.95275	北京市北京经济技术开发区经惠东路7号院1号楼3层301-2室	一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；计算机系统服务

四、控股股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东及实际控制人

1、控股股东情况

截至报告期末，芯华控股直接持有发行人 34,526,420 股股份，占发行人总股份的

25.47%，为公司的控股股东，其基本信息如下：

企业名称	天津芯华投资控股有限公司
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
法定代表人	孙镪
公司成立时间	2015 年 11 月 5 日
注册地址和主要经营地	天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209 (TG 第 667 号)
经营范围	以自有资金对集成电路业、电子信息业、新技术和新材料业进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业地址	天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209 (TG 第 667 号)
主营业务及其与发行人主营业务的关系	不存在实际业务经营,仅为持有发行人股份

截至 2025 年 12 月 31 日,芯华控股的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例
1	张秀云	176.24	17.62%
2	孙镪	104.57	10.46%
3	徐捷爽	76.42	7.64%
4	蔡琳	63.54	6.35%
5	周鹏	59.24	5.92%
6	付卫东	56.27	5.63%
7	段宁远	56.27	5.63%
8	王晓强	56.27	5.63%
9	肖斌	51.82	5.18%
10	周伟	33.78	3.38%
11	唐桂琴	31.37	3.14%
12	刘惠鹏	27.82	2.78%
13	陈爱华	24.12	2.41%
14	魏世华	20.94	2.09%
15	方汝华	19.47	1.95%
16	赵铁周	19.47	1.95%
17	王东光	12.06	1.21%
18	尹诗龙	10.47	1.05%
19	李朔男	10.47	1.05%

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例
20	王东海	10.47	1.05%
21	王梓	10.47	1.05%
22	赵运坤	10.47	1.05%
23	郝瑞庭	10.47	1.05%
24	毛怀宇	6.91	0.69%
25	刘学涛	5.24	0.52%
26	周昊鹏	5.24	0.52%
27	崔卫军	5.24	0.52%
28	庞磊	5.24	0.52%
29	袁琰	5.24	0.52%
30	郑华	5.24	0.52%
31	齐艳	5.24	0.52%
32	金晔	3.92	0.39%

芯华控股最近一年主要财务数据如下：

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日 (万元)
资产总额	21,600.25
所有者权益总额	4,933.52
营业收入	0
净利润	33,150.20

2、实际控制人情况

截至 2025 年 12 月 31 日，一致行动人孙镗、蔡琳、徐捷爽、周鹏通过控制芯华控股及直接持股，合计控制公司 25.61% 股份，为公司实际控制人。

根据孙镗、蔡琳、徐捷爽、周鹏于 2023 年 3 月 2 日签署的《一致行动人协议》，该协议自签署之日起生效，有效期 36 个月，期满后各方另行签署续期或终止协议，2026 年 3 月 1 日，孙镗、蔡琳、徐捷爽、周鹏签署《一致行动人协议之终止协议》，各方同意并确认《一致行动人协议》于 2026 年 3 月 1 日到期后不再续签。因此，截至本募集说明书出具日，孙镗、蔡琳、徐捷爽、周鹏的一致行动关系已经终止，公司的控制权状态已由孙镗、蔡琳、徐捷爽、周鹏四人共同控制变更为无实际控制人。

3、控股股东、实际控制人变化情况

发行人自上市以来，控股股东未发生变化。

2021年6月5日，因孙铄先生逝世，其持有的发行人控股股东芯华控股17.62%的股权由其配偶张秀云女士继承。截至2022年1月12日，继承手续已办理完毕，张秀云女士持有发行人控股股东芯华控股17.62%的股权，并与发行人其他实际控制人共同签署了《一致行动协议之补充协议》，发行人实际控制人由孙铄、孙镗、徐捷爽、蔡琳、周鹏、王晓强、付卫东和王皓8人变更为张秀云、孙镗、徐捷爽、蔡琳、周鹏、王晓强、付卫东和王皓8人。

2023年3月2日，发行人实际控制人张秀云、孙镗、徐捷爽、蔡琳、周鹏、王晓强、付卫东和王皓共同签署《〈一致行动人协议〉之终止协议》（以下简称《终止协议》），约定张秀云等8人的一致行动关系自《终止协议》签署之日起终止，不再续期。同日，孙镗、蔡琳、徐捷爽和周鹏签署新的《一致行动人协议》，协议有效期36个月，有效期至2026年3月。该协议自签署之日生效，发行人实际控制人由张秀云、孙镗、徐捷爽、蔡琳、周鹏、王晓强、付卫东和王皓8人变更为孙镗、蔡琳、徐捷爽和周鹏4人。

2026年3月1日孙镗、蔡琳、徐捷爽、周鹏签署《一致行动人协议之终止协议》，各方同意并确认《一致行动人协议》于2026年3月1日到期后不再续签。因此，截至本募集说明书出具日，孙镗、蔡琳、徐捷爽、周鹏的一致行动关系已经终止，公司的控制权状态已由孙镗、蔡琳、徐捷爽、周鹏四人共同控制变更为无实际控制人。

上述控制权变化系与《一致行动人协议》的续期安排有关，与本次发行不直接相关。《证券法》《注册管理办法》均未将控制权变更作为向不特定对象发行可转换公司债券的发行条件，因此本次控制权变更事项不影响本次发行条件，公司控制权变更前后均符合《证券法》《注册管理办法》所规定的向不特定对象发行可转换公司债券的发行条件。

（二）股份是否存在质押或其他有争议情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结等权利限制的情形，亦不存在争议情形。

（三）控股股东及实际控制人投资的其他企业

1、控股股东控制的其他企业基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，除公司及其子公司外，公司控股股东芯华控股不存在控制的其他企业。

2、实际控制人控制的其他企业的基本情况

除发行人及其下属子公司外，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人实际控制人之一徐捷爽还控制上海惠适。

截至 2025 年 12 月 31 日，上海惠适的基本情况如下：

公司名称	上海惠适电子有限公司
法定代表人	徐捷爽
注册资本	10 万元
实收资本	10 万元
成立日期	2008 年 10 月 22 日
注册地址	青浦区练塘镇章练塘路 588 号 A-221 室
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
经营范围	销售电子材料、包装材料，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限	2008 年 10 月 22 日至 2028 年 10 月 21 日

五、发行人、控股股东、实际控制人以及发行人董事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况以及与本次发行相关的承诺事项

报告期内，发行人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员作出的重要承诺内容及履行情况如下：

（一）本次发行前发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况

公司首次公开发行股票相关主体已作出的重要承诺及其履行情况参见发行人于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华峰测控技术股份有限公司 2025 年年度报告》之“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。截至本募集说明书签署日，本次发行前相关主体所作出的重要承诺履行情况正常。

（二）与本次发行相关的承诺事项

1、公司的控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于本次发行摊薄即期回报填补措施的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，相关主体对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺，具体情况如下：

（1）公司控股股东、实际控制人的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作如下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本公司本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应责任；

3、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本公司本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”

（2）公司董事、高级管理人员的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人相关的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺股权激励方案的行权条件将与公司填

补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”

2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、及高级管理人员关于本次可转债发行认购事宜及减持情况的承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员关于本次可转债发行认购事宜及减持情况的承诺

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员就本次可转债发行认购事宜及减持情况作出如下承诺：

1、如公司启动本次可转债发行，本人将按照相关法律法规关于股票及可转债交易的规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本人及本人配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的最后一次日期间隔不满六个月（含）的，本人及本人配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债；

2、若本人及本人配偶、父母、子女认购本次发行的可转债的，本人承诺，本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守相关法律法规关于股票及可转债交易的规定，在认购本次发行的可转债后六个月内不减持公司的股票或可转债；

3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束，并承诺将严格遵守相关法律法规关于股票及可转债交易的规定。若本人及本人配偶、父母、子女违反上述规定或本承诺，应依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失，本人将依法承担赔偿责任；

4、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(2) 独立董事关于本次可转债发行认购事宜的承诺

公司独立董事关于本次可转债发行认购事宜作出如下承诺：

1、本人及本人配偶、父母、子女承诺不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的发行认购；

2、本人及本人配偶、父母、子女自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人配偶、父母、子女违反上述承诺，本人及本人配偶、父母、子女将依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人及本人配偶、父母、子女将依法承担赔偿责任。

第四节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据反映了公司最近三年的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度经审计的财务报告，财务指标根据上述财务报表为基础编制。

公司提醒投资者关注公司财务报告和审计报告全文，以获取更详尽的财务资料。

一、最近三年财务报表审计情况

（一）审计情况

公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度财务报告已经审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，分别出具了大信审字[2024]第 3-00293 号、大信审字[2025]第 3-00109 号和大信审字[2026]第 3-00310 号标准无保留意见审计报告。

（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

公司根据自身业务特点和所处行业，从项目性质及金额两方面判断与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目的性质是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量，是否会引起特别的风险。在判断项目金额大小的重要性时，综合考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等项目金额比重情况。

以下财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、最近三年财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	206,642.62	208,964.94	202,679.88
交易性金融资产	11,812.01	7,911.95	9,369.35
应收票据	18,700.87	19,066.76	6,454.73
应收账款	55,366.09	32,578.11	26,277.87

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
预付款项	1,254.71	270.89	120.99
其他应收款	717.47	400.01	209.47
存货	29,959.87	17,744.71	14,163.01
合同资产	340.53	193.73	96.52
一年内到期的非流动资产	7,618.40	4,350.20	3,808.04
其他流动资产	7,056.40	1,947.94	977.28
流动资产合计	339,468.97	293,429.26	264,157.15
非流动资产：			
其他权益工具投资	22,074.02	20,044.99	21,761.62
其他非流动金融资产	14,317.27	11,618.29	8,399.12
投资性房地产	4.31	4.31	4.31
固定资产	42,183.11	42,060.75	40,182.31
使用权资产	2,388.77	1,465.83	321.74
无形资产	5,523.60	2,718.62	2,854.84
长期待摊费用	364.34	200.30	68.36
递延所得税资产	3,382.88	1,753.99	1,569.44
其他非流动资产	20,368.27	7,511.71	7,367.57
非流动资产合计	110,606.57	87,378.79	82,529.30
资产总计	450,075.53	380,808.05	346,686.45
流动负债：			
应付账款	8,274.94	5,426.28	2,209.41
预收款项	3.69	3.64	3.68
合同负债	7,757.17	5,625.30	2,767.40
应付职工薪酬	6,276.53	4,463.43	3,424.19
应交税费	4,677.50	2,503.05	1,609.94
其他应付款	808.13	563.91	464.10
一年内到期的非流动负债	688.97	407.31	232.53
其他流动负债	1,897.14	406.22	289.55
流动负债合计	30,384.07	19,399.13	11,000.82
非流动负债：			
长期借款	-	24.69	-
租赁负债	1,651.02	1,034.17	76.28
预计负债	-	903.86	-

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
递延收益	5,842.00	-	-
递延所得税负债	3,359.01	2,418.11	2,359.96
非流动负债合计	10,852.03	4,380.83	2,436.24
负债合计	41,236.10	23,779.97	13,437.06
股东权益：			
股本	13,553.32	13,543.94	13,536.72
资本公积	184,473.61	181,519.81	180,076.44
减：库存股	990.59	1,498.65	-
其他综合收益	13,206.53	10,953.48	11,804.20
盈余公积	6,776.66	6,771.97	6,768.36
未分配利润	190,845.02	145,737.53	121,063.67
归属于母公司股东权益合计	407,864.55	357,028.08	333,249.40
少数股东权益	974.89	-	-
股东权益合计	408,839.44	357,028.08	333,249.40
负债和股东权益总计	450,075.53	380,808.05	346,686.45

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业收入	134,641.06	90,534.54	69,086.19
减：营业成本	35,284.04	24,164.16	19,900.71
税金及附加	1,388.92	1,160.65	852.87
销售费用	15,682.34	12,844.83	10,508.10
管理费用	6,513.00	5,794.07	5,452.08
研发费用	26,571.67	17,236.82	13,198.02
财务费用	-3,519.86	-5,117.62	-5,143.34
其中：利息费用	84.99	39.66	20.82
利息收入	4,439.16	4,697.67	4,647.66
加：其他收益	2,349.30	3,825.16	2,370.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	171.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,605.23	-1,232.10	-303.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,179.80	-882.27	44.70

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-174.32	-93.48	-72.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5.17	2.03	1.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,316.20	36,070.96	26,529.33
加：营业外收入	14.31	67.92	30.66
减：营业外支出	11.95	16.40	0.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,318.56	36,122.49	26,559.43
减：所得税费用	4,708.96	2,731.00	1,394.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,609.61	33,391.48	25,165.23
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,609.61	33,391.48	25,165.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	53,609.61	33,391.48	25,165.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	3,900.37	1,117.02	2,442.52
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	3,900.37	1,117.02	2,442.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,830.97	1,056.87	2,452.03
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	3,830.97	1,056.87	2,452.03
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	69.41	60.15	-9.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-	-
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
（6）外币财务报表折算差额	69.41	60.15	-9.51
（7）其他	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	57,509.98	34,508.50	27,607.75
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	57,509.98	34,508.50	27,607.75

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

(三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	129,124.18	84,919.44	83,894.00
收到的税费返还	2,237.01	2,913.01	3,705.23
收到其他与经营活动有关的现金	8,913.15	1,801.72	3,680.07
经营活动现金流入小计	140,274.35	89,634.17	91,279.30
购买商品、接受劳务支付的现金	52,705.83	28,379.05	19,504.83
支付给职工以及为职工支付的现金	34,942.54	26,469.32	21,287.33
支付的各项税费	13,851.54	9,962.51	11,575.29
支付其他与经营活动有关的现金	8,354.34	6,013.56	6,763.25
经营活动现金流出小计	109,854.26	70,824.44	59,130.69
经营活动产生的现金流量净额	30,420.08	18,809.73	32,148.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	24,027.20	6,532.24	1,248.30
取得投资收益收到的现金	2,669.49	3,233.46	2,493.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.35	3.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	18,302.67	9,183.90	-
投资活动现金流入小计	45,005.71	18,952.60	3,741.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,618.70	3,081.60	2,547.18
投资支付的现金	41,563.93	8,164.64	18,681.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,901.38	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	7,847.90
投资活动现金流出小计	50,084.01	11,246.24	29,076.75
投资活动产生的现金流量净额	-5,078.30	7,706.35	-25,335.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	986.65	488.55	2,759.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	986.65	488.55	2,759.00
偿还债务支付的现金	40.53	57.17	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,145.35	10,682.43	12,750.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	752.46	1,983.36	278.09
筹资活动现金流出小计	10,938.34	12,722.97	13,028.39
筹资活动产生的现金流量净额	-9,951.69	-12,234.42	-10,269.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348.69	186.45	101.39
五、现金及现金等价物净增加额	15,041.40	14,468.11	-3,354.82
加：期初现金及现金等价物余额	111,817.25	97,349.14	100,703.96
六、期末现金及现金等价物余额	126,858.65	111,817.25	97,349.14

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则等规定（以下称“企业会计准则”），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

（二）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

（三）合并财务报表范围及其变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司纳入合并财务报表范围共有 8 家一级子公司。子公司具体情况参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“三、公司组织结构及重要权益投资情况”之“（二）公司的对外投资情况”。

最近三年合并财务报表范围主要变化情况如下：

1、2025 年合并范围的变化

公司购买了福州华峰百分之八十的股权。

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(万元)	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
福州华峰	2025年12月31日	4,000.00	80.00	现金购买	2025年12月31日	取得实际控制权

注：福州华峰下属上海华峰、新加坡华峰随收购一并纳入公司合并范围

公司新设子公司 B 企业，自成立之日起纳入合并范围。

2、2024 年合并范围的变化

公司全资子公司爱格测试技术有限公司购买了 AccoTEST Technology Japan 株式会社百分之百的股权。

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(万元)	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
AccoTEST Technology Japan 株式会社	2024年4月1日	30.90	100.00	现金购买	2024年4月1日	取得实际控制权

公司子公司盛态思软件(天津)有限责任公司进行了清算注销，于2024年6月份完成了注销程序，注销后不再纳入合并范围。

3、2023 年度合并范围的变化

公司新设全资子公司 ACCOTEST ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN.BHD.，自成立之日起纳入合并范围。

四、最近三年主要财务指标及非经常性损益明细表

(一) 主要财务指标表

项目	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度
流动比率(倍)	11.17	15.13	24.01
速动比率(倍)	10.19	14.21	22.73
资产负债率(合并)	9.16%	6.24%	3.88%
资产负债率(母公司)	14.84%	11.90%	9.15%
应收账款周转率(次)	2.76	2.72	2.06
存货周转率(次)	1.45	1.48	1.19
归属于母公司所有者的每	30.12	26.40	24.62

项目	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度
股净资产（元）			
每股经营活动现金净流量（元）	2.25	1.39	2.37
每股净现金流量（元）	1.11	1.07	-0.25
归属于母公司所有者的净利润（万元）	53,609.61	33,391.48	25,165.23
研发费用占营业总收入的比重	19.74%	19.04%	19.10%

注1：上述指标除资产负债率（母公司）外均依据合并报表口径计算。

各指标的具体计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均账面余额
- 6、归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额（扣除期末库存股）
- 7、每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数（扣除期末库存股）
- 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数（扣除期末库存股）
- 9、研发费用占营业总收入的比重=各项研发费用合计/营业总收入

（二）公司最近三年净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目		2025年度	2024年度	2023年度
扣除非经常 损益前	基本每股收益（元/股）	3.96	2.47	1.86
	稀释每股收益（元/股）	3.95	2.47	1.86
扣除非经常损益前加权平均净资产收益率		14.08%	9.69%	7.80%
扣除非经常 损益后	基本每股收益（元/股）	3.64	2.51	1.87
	稀释每股收益（元/股）	3.63	2.51	1.87
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率		12.92%	9.87%	7.85%

(三) 公司最近三年非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-9.43	1.66	0.93
2. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	552.35	414.72	81.02
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,605.23	-1,232.10	-303.90
4. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	28.30	-
5. 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	-
6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6.62	-4.58	2.98
7. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	29.35	67.56	47.18
减：所得税影响额	778.17	-111.20	-26.17
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
合计	4,405.96	-613.26	-145.63

五、会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正**(一) 会计政策变更****1、2023 年度**

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，

如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。该事项对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表影响如下：

单位：元

合并报表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日	变更后 2023 年 1 月 1 日	影响数
资产：			
递延所得税资产	16,546,102.64	17,344,153.18	798,050.54
负债：			
递延所得税负债	18,237,134.51	19,035,185.05	798,050.54

单位：元

母公司报表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日	变更后 2023 年 1 月 1 日	影响数
资产：			
递延所得税资产	13,651,458.82	14,449,509.36	798,050.54
负债：			
递延所得税负债	18,076,784.71	18,874,835.25	798,050.54

2、2024 年度

(1) 2023 年财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对公司 2024 年度内财务报表无影响。

(2) 2024 年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》，其中明确了“保证类质保费用应计入营业成本”相关内容。公司依据《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》的规定对原会计政策进行相应变更，将保证类质保费用计入营业成本，不再计入销售费用。根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。

该事项对 2023 年度财务报表影响如下：

单位：元

合并报表项目	变更前 2023 年度	变更后 2023 年度	影响数
营业成本	190,169,245.94	199,007,145.34	8,837,899.40

合并报表项目	变更前 2023 年度	变更后 2023 年度	影响数
销售费用	113,918,938.06	105,081,038.66	-8,837,899.40

单位：元

母公司报表项目	变更前 2023 年度	变更后 2023 年度	影响数
营业成本	335,922,984.55	340,745,991.79	4,823,007.24
销售费用	98,844,105.06	94,021,097.82	-4,823,007.24

为保持报告期内数据的可比性，在本募集说明书中，对 2022 年度财务报表中的营业成本及销售费用同口径进行了相应调整，调增 2022 年度营业成本 544.24 万元，调减 2022 年度销售费用 544.24 万元。

3、2025 年度

不存在重大会计政策变更。

(二) 会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更事项。

(三) 会计差错更正

报告期内，公司无重大的会计差错更正事项。

六、财务状况分析

(一) 资产情况

1、资产的构成及分析

截至报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	339,468.97	75.42%	293,429.26	77.05%	264,157.15	76.19%
非流动资产	110,606.57	24.58%	87,378.79	22.95%	82,529.30	23.81%
资产总计	450,075.53	100.00%	380,808.05	100.00%	346,686.45	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 346,686.45 万元、380,808.05 万元和 450,075.53 万元，呈持续增长趋势，公司经营保持稳健，带动公司资产规模增长。

报告期各期末，流动资产占资产总计的比例分别为 76.19%、77.05%和 75.42%。报告期各期末公司流动资产占比整体保持在 75%以上水平，资产流动性较好。

2、流动资产的构成及分析

截至报告期各期末，公司流动资产构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	206,642.62	60.87%	208,964.94	71.21%	202,679.88	76.73%
交易性金融资产	11,812.01	3.48%	7,911.95	2.70%	9,369.35	3.55%
应收票据	18,700.87	5.51%	19,066.76	6.50%	6,454.73	2.44%
应收账款	55,366.09	16.31%	32,578.11	11.10%	26,277.87	9.95%
预付款项	1,254.71	0.37%	270.89	0.09%	120.99	0.05%
其他应收款	717.47	0.21%	400.01	0.14%	209.47	0.08%
存货	29,959.87	8.83%	17,744.71	6.05%	14,163.01	5.36%
合同资产	340.53	0.10%	193.73	0.07%	96.52	0.04%
一年内到期的非流动资产	7,618.40	2.24%	4,350.20	1.48%	3,808.04	1.44%
其他流动资产	7,056.40	2.08%	1,947.94	0.66%	977.28	0.37%
流动资产合计	339,468.97	100.00%	293,429.26	100.00%	264,157.15	100.00%

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款和存货构成。报告期各期末，公司流动资产分别为 264,157.15 万元、293,429.26 万元和 339,468.97 万元。2024 年末，公司流动资产金额同比上一年增长 29,272.11 万元，同比增幅为 11.08%，主要系公司应收票据、应收账款、存货等经营性流动资产增长所致。2025 年末，公司流动资产金额较 2024 年末增长 46,039.71 万元，增幅为 15.69%，主要系公司应收账款、存货等经营性流动资产增长所致。

报告期各期末，公司流动资产的变动情况及原因如下：

(1) 货币资金

截至报告期各期末，公司货币资金的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
库存现金	2.83	2.80	0.51
银行存款	202,638.73	205,818.27	200,141.54
其他货币资金	1.39	12.88	19.51
未到期应收利息	3,999.67	3,130.99	2,518.32
合计	206,642.62	208,964.94	202,679.88
其中：存放在境外的款项总额	1,734.11	1,522.33	559.01
受限货币资金	502.14	11.50	19.51

公司货币资金主要由库存现金、银行存款、其他货币资金和未到期应收利息资金构成。截至2023年末、2024年末及2025年末，公司货币资金余额分别为202,679.88万元、208,964.94万元及206,642.62万元，占流动资产的比例分别为76.73%、71.21%及60.87%。

2025年2月，公司子公司天津华峰因尚未了结的施工合同纠纷被对方当事人申请冻结银行存款5,021,389.09元，天津华峰已向银行申请出具保函用以解冻被冻结账户，在积极应对相关案件的同时，天津华峰已提出反请求申请，以积极维护公司合法权益。具体诉讼情况请见本节之“十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项及重要期后事项”之“（二）重大仲裁、诉讼及其他或有事项”。

（2）交易性金融资产

截至报告期各期末，公司交易性金融资产的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,812.01	100.00%	7,911.95	100.00%	9,369.35	100.00%
其中：权益工具投资	11,812.01	100.00%	7,911.95	100.00%	9,369.35	100.00%
合计	11,812.01	100.00%	7,911.95	100.00%	9,369.35	100.00%

公司交易性金融资产为权益工具投资。截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司交易性金融资产余额分别为 9,369.35 万元、7,911.95 万元及 11,812.01 万元，占流动资产的比例分别为 3.55%、2.70%及 3.48%。公司交易性金融资产主要为参与上市公司芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“芯联集成”）科创板 IPO 战略配售、参与思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“思瑞浦”）向特定对象发行股票所持有的股票，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
芯联集成	6,289.19	53.24%	4,822.65	60.95%	4,719.24	50.37%
思瑞浦	5,522.83	46.76%	3,089.30	39.05%	4,650.11	49.63%
合计	11,812.01	100.00%	7,911.95	100.00%	9,369.35	100.00%

（3）应收票据

截至报告期各期末，公司应收票据的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	18,319.74	18,754.26	5,529.38
商业承兑汇票	493.94	328.95	974.05
账面余额小计	18,813.68	19,083.21	6,503.43
减：坏账准备	112.82	16.45	48.70
账面价值合计	18,700.87	19,066.76	6,454.73

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司应收票据账面价值分别为 6,454.73 万元、19,066.76 万元及 18,700.87 万元，占流动资产的比例分别为 2.44%、6.50%及 5.51%。2024 年末，公司应收票据较 2023 年末增加 12,612.03 万元，增幅为 195.39%，主要系营业收入规模增加，应收票据相应增加，同时期末应收票据未到期承兑所致。2025 年末，公司应收票据较 2024 年末减少 365.89 万元，降幅为 1.92%。

应收票据坏账计提情况具体如下：

单位：万元

类别	2025年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	18,813.68	100.00%	112.82	0.60%	18,700.87
其中：组合1：银行承兑汇票	18,319.74	97.37%	-	-	18,319.74
组合2：商业承兑汇票	493.94	2.63%	112.82	22.84%	381.12
合计	18,813.68	100.00%	112.82	0.60%	18,700.87
类别	2024年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	19,083.21	100.00%	16.45	0.09%	19,066.76
其中：组合1：银行承兑汇票	18,754.26	98.28%	-	-	18,754.26
组合2：商业承兑汇票	328.95	1.72%	16.45	5.00%	312.50
合计	19,083.21	100.00%	16.45	0.09%	19,066.76
类别	2023年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	6,503.43	100.00%	48.70	0.75%	6,454.73
其中：组合1：银行承兑汇票	5,529.38	85.02%	-	-	5,529.38
组合2：商业承兑汇票	974.05	14.98%	48.70	5.00%	925.35
合计	6,503.43	100.00%	48.70	0.75%	6,454.73

出于谨慎性考虑，公司对商业承兑汇票按账龄计提坏账准备。报告期内，公司单项应收票据不存在重大回收风险，因此商业票据均按组合计提坏账准备。

(4) 应收账款

1) 应收账款构成及变动情况

截至报告期各期末，公司应收账款具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应收账款账面余额	60,737.47	36,886.12	29,681.38
坏账准备	5,371.38	4,308.01	3,403.51
应收账款账面价值	55,366.09	32,578.11	26,277.87
营业收入	134,641.06	90,534.54	69,086.19
应收账款账面价值/ 营业收入	41.12%	35.98%	38.04%

截至2023年末、2024年末及2025年末，公司应收账款账面价值分别为26,277.87万元、32,578.11万元和55,366.09万元，占流动资产的比例分别为9.95%、11.10%及16.31%。

报告期内，公司应收账款账面价值随公司收入变化而变动。2024年末，公司应收账款账面价值较2023年末增加6,300.24万元，同比增长23.98%，主要系公司销售规模增长所致。2025年末，公司应收账款账面价值较2024年末增加22,787.98万元，增长69.95%，主要系公司销售规模增长所致。

报告期内，公司应收账款账面价值占营业收入的比重分别为38.04%、35.98%和41.12%，公司应收账款变动趋势与收入变动保持一致，报告期内公司应收账款账面价值占营业收入的比重整体保持稳定。

2) 应收账款账龄分析

截至报告期各期末，公司应收账款余额账龄分布情况如下：

单位：万元

账龄	2025年12月31日			
	账面余额	占比	坏账准备	计提比例
1年以内	54,690.46	90.04%	2,734.52	5.00%
1至2年	4,619.37	7.61%	1,385.81	30.00%
2至3年	588.64	0.97%	412.05	70.00%
3年以上	838.99	1.38%	838.99	100.00%
合计	60,737.47	100.00%	5,371.38	8.84%
账龄	2024年12月31日			
	账面余额	占比	坏账准备	计提比例

1年以内	30,660.11	83.12%	1,533.01	5.00%
1至2年	4,092.77	11.10%	1,227.83	30.00%
2至3年	1,953.56	5.30%	1,367.49	70.00%
3年以上	179.68	0.49%	179.68	100.00%
合计	36,886.12	100.00%	4,308.01	11.68%
账龄	2023年12月31日			
	账面余额	占比	坏账准备	计提比例
1年以内	24,430.33	82.31%	1,221.52	5.00%
1至2年	3,823.47	12.88%	1,147.04	30.00%
2至3年	1,308.75	4.41%	916.13	70.00%
3年以上	118.83	0.40%	118.83	100.00%
合计	29,681.38	100.00%	3,403.51	11.47%

截至2023年末、2024年末及2025年末，公司1年以内的应收账款余额占比分别为82.31%、83.12%和90.04%。从账龄上看，报告期各期末，公司1年以内应收账款为主要组成部分。公司主要客户为国内外大型集团公司或上市公司，客户实力较强、信用度高，应收账款回收风险较小。报告期内应收账款回款情况良好，未发生重大坏账情况。

3) 应收账款按坏账计提方法分类情况

截至报告期各期末，公司应收账款余额分类情况如下表所示：

单位：万元

类别	2025年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	60,737.47	100.00%	5,371.38	8.84%	55,366.09
其中：账龄组合	60,737.47	100.00%	5,371.38	8.84%	55,366.09
合计	60,737.47	100.00%	5,371.38	8.84%	55,366.09
类别	2024年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的	-	-	-	-	-

应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	36,886.12	100.00%	4,308.01	11.68%	32,578.11
其中：账龄组合	36,886.12	100.00%	4,308.01	11.68%	32,578.11
合计	36,886.12	100.00%	4,308.01	11.68%	32,578.11
类别	2023年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	29,681.38	100.00%	3,403.51	11.47%	26,277.87
其中：账龄组合	29,681.38	100.00%	3,403.51	11.47%	26,277.87
合计	29,681.38	100.00%	3,403.51	11.47%	26,277.87

截至2023年末、2024年末及2025年末，公司应收账款全部为按组合计提坏账准备。

4) 公司应收账款前五大情况

截至报告期各期末，公司应收账款余额前五名的情况如下：

单位：万元

2025年12月31日			
单位名称	应收账款余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户4	12,701.43	20.91%	641.25
客户56	4,662.70	7.68%	371.24
客户2	4,241.21	6.98%	213.12
客户16	2,803.54	4.62%	140.18
客户55	2,684.08	4.42%	134.20
合计	27,092.96	44.61%	1,499.99
2024年12月31日			
单位名称	应收账款余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户13	2,943.64	7.98%	272.79
客户1	2,457.05	6.66%	122.85
客户4	2,024.02	5.49%	103.58

客户 3	1,840.48	4.99%	92.02
客户 5	1,817.74	4.93%	90.89
合计	11,082.93	30.05%	682.13
2023 年 12 月 31 日			
单位名称	应收账款余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 10	1,527.51	5.15%	76.68
客户 14	1,205.67	4.06%	60.28
客户 11	1,075.82	3.62%	219.44
客户 15	1,042.72	3.51%	52.14
客户 16	887.00	2.99%	44.35
合计	5,738.72	19.33%	452.89

5) 与同行业公司相比应收账款坏账计提方法及比例

截至报告期各期末，公司应收账款坏账计提比例与可比上市公司的对比情况如下：

公司名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
长川科技	5.23%	6.09%	6.04%
联动科技	5.99%	6.52%	7.23%
平均值	5.61%	6.31%	6.64%
公司	8.84%	11.68%	11.47%

注 1：应收账款坏账计提比例=坏账准备/应收账款账面余额；

注 2：数据源自各公司定期报告、同花顺 iFind。

如上表所示，公司应收账款坏账计提比例高于同行业可比公司，主要系公司基于谨慎性原则，对于相同账龄的应收账款坏账计提比例更高所致。

(5) 预付款项

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司预付款项的余额分别为 120.99 万元、270.89 万元及 1,254.71 万元，占流动资产的比例分别为 0.05%、0.09%及 0.37%。报告期内，公司预付款项整体规模较小。

(6) 其他应收款

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司其他应收款账面价值分别为 209.47 万元、400.01 万元和 717.47 万元，占流动资产的比例分别为 0.08%、0.14%及 0.21%。

公司其他应收款主要为保证金及押金，报告期内整体规模较小。

(7) 存货

截至报告期各期末，公司存货的明细情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	15,143.36	49.63%	7,123.93	39.24%	7,536.31	52.02%
半成品及组装件	3,189.63	10.45%	1,693.89	9.33%	1,339.76	9.25%
产成品	2,726.20	8.94%	2,658.16	14.64%	1,960.95	13.54%
发出商品	5,114.37	16.76%	4,313.87	23.76%	2,117.47	14.62%
在产品	2,104.27	6.90%	1,505.38	8.29%	1,065.90	7.36%
委托加工物资	2,232.87	7.32%	861.35	4.74%	466.51	3.22%
余额合计	30,510.69	100.00%	18,156.58	100.00%	14,486.90	100.00%
减：跌价准备		550.82		411.87		323.89
账面价值		29,959.87		17,744.71		14,163.01

公司的存货主要为原材料、发出商品和产成品等。截至2023年末、2024年末及2025年末，公司存货账面价值分别为14,163.01万元、17,744.71万元及29,959.87万元，占流动资产的比重分别为5.36%、6.05%及8.83%。2024年末，公司存货账面价值较2023年末增加3,581.70万元，同比增幅为25.29%，主要系销售同比增长，发出商品、在产品、半成品及组装件等对应增加所致。2025年末，公司存货账面价值较2024年末增加12,215.16万元，同比增幅为68.84%，主要系销售规模增长及提前备货，发出商品、半成品及组装件、原材料及委托加工物资等增加所致。

报告期各期末，公司存货余额及其跌价准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,143.36	210.48	14,932.87
半成品及组装件	3,189.63	340.34	2,849.29
产成品	2,726.20	-	2,726.20
发出商品	5,114.37	-	5,114.37

在产品	2,104.27	-	2,104.27
委托加工物资	2,232.87	-	2,232.87
合计	30,510.69	550.82	29,959.87
项目	2024年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,123.93	173.34	6,950.59
半成品及组装件	1,693.89	238.53	1,455.36
产成品	2,658.16	-	2,658.16
发出商品	4,313.87	-	4,313.87
在产品	1,505.38	-	1,505.38
委托加工物资	861.35	-	861.35
合计	18,156.58	411.87	17,744.71
项目	2023年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,536.31	131.37	7,404.95
半成品及组装件	1,339.76	192.53	1,147.23
产成品	1,960.95	-	1,960.95
发出商品	2,117.47	-	2,117.47
在产品	1,065.90	-	1,065.90
委托加工物资	466.51	-	466.51
合计	14,486.90	323.89	14,163.01

公司严格按照存货成本与可变现净值孰低的方式进行存货跌价准备的计提，公司报告期各期的存货跌价准备分别为 323.89 万元、411.87 万元及 550.82 万元，包括对原材料、半成品及组装件的存货跌价准备计提。

(8) 合同资产

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司合同资产账面价值分别为 96.52 万元、193.73 万元和 340.53 万元，占流动资产的比例分别为 0.04%、0.07%及 0.10%。公司合同资产主要为质保金，报告期内整体规模较小。

(9) 一年内到期的非流动资产

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司一年内到期的非流动资产账面价值

分别为 3,808.04 万元、4,350.20 万元和 7,618.40 万元，占流动资产的比例分别为 1.44%、1.48%及 2.24%。公司一年内到期的非流动资产主要为一年内到期的大额定期存单本金及利息，报告期内整体规模较小。

（10）其他流动资产

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司其他流动资产账面价值分别为 977.28 万元、1,947.94 万元和 7,056.40 万元，占流动资产的比例分别为 0.37%、0.66%及 2.08%。公司其他流动资产主要为大额定期存单及利息、预缴所得税、待摊费用、应收出口退税款、留抵税额及待认证进项税额等，报告期内整体规模较小。2025 年末，公司其他流动资产较 2024 年末增加 5,108.46 万元，增幅为 262.25%，主要系大额存单增加所致。

3、非流动资产的构成及分析

截至报告期各期末，公司非流动资产构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
非流动资产：						
其他权益工具投资	22,074.02	19.96%	20,044.99	22.94%	21,761.62	26.37%
其他非流动金融资产	14,317.27	12.94%	11,618.29	13.30%	8,399.12	10.18%
投资性房地产	4.31	0.00%	4.31	0.00%	4.31	0.01%
固定资产	42,183.11	38.14%	42,060.75	48.14%	40,182.31	48.69%
使用权资产	2,388.77	2.16%	1,465.83	1.68%	321.74	0.39%
无形资产	5,523.60	4.99%	2,718.62	3.11%	2,854.84	3.46%
长期待摊费用	364.34	0.33%	200.30	0.23%	68.36	0.08%
递延所得税资产	3,382.88	3.06%	1,753.99	2.01%	1,569.44	1.90%
其他非流动资产	20,368.27	18.42%	7,511.71	8.60%	7,367.57	8.93%
非流动资产合计	110,606.57	100.00%	87,378.79	100.00%	82,529.30	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他非流动资产构成。报告期各期末，公司非流动资产分别为 82,529.30 万元、87,378.79 万元和 110,606.57 万元，呈持续上升趋势。报告期各期末，公司非流动资产的变动情况及原因如下：

（1）其他权益工具投资

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司其他权益工具投资账面价值分别为 21,761.62 万元、20,044.99 万元和 22,074.02 万元，占非流动资产的比例分别为 26.37%、22.94%及 19.96%。

报告期各期末，公司其他权益工具投资情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
江苏芯长征微电子集团股份有限公司	3,482.33	15.78%	3,482.33	17.37%	3,482.33	16.00%
上海韬盛电子科技股份有限公司	2,870.00	13.00%	5,348.00	26.68%	7,064.62	32.46%
成都中科四点零科技有限公司	2,606.64	11.81%	2,606.64	13.00%	2,606.64	11.98%
苏州联讯仪器股份有限公司	12,615.04	57.15%	8,108.02	40.45%	8,108.02	37.26%
北京士模微电子有限责任公司	500.00	2.27%	500.00	2.49%	500.00	2.30%
合计	22,074.02	100.00%	20,044.99	100.00%	21,761.62	100.00%

2024 年末，公司其他权益工具投资账面价值较 2023 年末减少 1,716.62 万元，同比下降 7.89%，主要系公司转让部分上海韬盛电子科技股份有限公司股权所致。2025 年末，公司其他权益工具投资账面价值较 2024 年末增加 2,029.02 万元，增幅为 10.12%。

(2) 其他非流动金融资产

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司其他非流动金融资产账面价值分别为 8,399.12 万元、11,618.29 万元和 14,317.27 万元，占非流动资产的比例分别为 10.18%、13.30%及 12.94%。

报告期各期末，公司其他非流动金融资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）	6,403.39	44.72%	6,612.37	56.91%	4,559.16	54.28%
南京武岳峰汇芯创业投资合伙企	4,500.97	31.44%	3,517.03	30.27%	3,839.96	45.72%

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
业（有限合伙）						
合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）	3,412.91	23.84%	1,488.89	12.82%	-	0.00%
合计	14,317.27	100.00%	11,618.29	100.00%	8,399.12	100.00%

公司其他非流动金融资产均为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，为对广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）、南京武岳峰汇芯创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）等产业基金的投资。

（3）投资性房地产

截至2023年末、2024年末及2025年末，公司投资性房地产账面价值均为4.31万元，占非流动资产的比例分别为0.01%、0.00%及0.00%，报告期内整体规模较小。

（4）固定资产

截至报告期各期末，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
一、账面原值合计：	52,257.48	49,875.72	45,798.39
其中：房屋及建筑物	43,771.24	43,770.94	41,328.69
电子设备	7,962.53	5,681.75	4,153.76
机器设备	116.07	77.58	58.23
运输工具	184.54	185.65	142.88
办公设备及其他	223.10	159.79	114.84
二、累计折旧合计：	10,074.37	7,814.97	5,616.08
其中：房屋及建筑物	5,204.11	4,109.45	3,078.76
电子设备	4,587.28	3,470.13	2,339.58
机器设备	29.80	22.18	16.31
运输工具	153.37	141.76	134.90
办公设备及其他	99.81	71.44	46.52
三、减值准备合计	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
电子设备	-	-	-
机器设备	-	-	-
运输工具	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-
四、账面价值合计	42,183.11	42,060.75	40,182.31
其中：房屋及建筑物	38,567.13	39,661.49	38,249.93
电子设备	3,375.25	2,211.62	1,814.17
机器设备	86.27	55.40	41.91
运输工具	31.17	43.89	7.98
办公设备及其他	123.29	88.35	68.31

截至2023年末、2024年末及2025年末，公司固定资产的账面价值分别为40,182.31万元、42,060.75万元和42,183.11万元，占非流动资产的比例分别为48.69%、48.14%和38.14%。公司固定资产由房屋及建筑物、电子设备、机器设备、运输工具、办公设备及其他固定资产组成，其中，房屋及建筑物和电子设备占比较高。报告期内，公司固定资产规模整体保持稳定。

报告期各期末，公司固定资产状况良好，不存在减值迹象，未计提减值准备；截至2025年末，公司无重大闲置或待处置的固定资产。

发行人固定资产折旧政策与同行业可比公司的比较情况如下：

公司名称	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他
长川科技	20年	通用设备3-5年；专用设备3-10年	4年	-	-
联动科技	10-40年	5-10年	5年	-	5-10年
公司	20-40年	10年	4年	3-5年	3-5年

由上表可见，公司的固定资产折旧年限与可比上市公司的计提比例较为类似。

(5) 使用权资产

截至2023年末、2024年末及2025年末，公司使用权资产分别为321.74万元、1,465.83万元和2,388.77万元，占非流动资产的比例分别为0.39%、1.68%和2.16%，报

告期内整体规模占比较小。2025 年末，公司使用权资产较上年末增加 922.94 万元，增幅为 62.96%，主要系新增租房增加导致。

(6) 无形资产

截至报告期各期末，公司无形资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	6,376.63	3,451.88	3,377.26
其中：土地使用权	2,133.14	2,133.14	2,133.14
软件	1,701.87	1,318.75	1,244.13
专利权	2,541.63	-	-
二、累计摊销合计：	853.03	733.26	522.43
其中：土地使用权	284.42	241.76	199.09
软件	568.61	491.51	323.33
专利权	-	-	-
三、减值准备合计	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-
软件	-	-	-
专利权	-	-	-
四、账面价值合计	5,523.60	2,718.62	2,854.84
其中：土地使用权	1,848.72	1,891.38	1,934.04
软件	1,133.25	827.24	920.80
专利权	2,541.63	-	-

公司无形资产由土地使用权、专利权和软件组成。截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司无形资产账面价值分别为 2,854.84 万元、2,718.62 万元和 5,523.60 万元，占非流动资产的比例分别为 3.46%、3.11%和 4.99%。2025 年末，公司无形资产较 2024 年末增加 2,804.98 万元，增幅为 103.18%，主要系新增专利权所致。截至 2025 年末，公司无形资产的情况参见“第四节 发行人基本情况”之“十二、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（二）主要无形资产”。

(7) 长期待摊费用

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司长期待摊费用分别为 68.36 万元、200.30

万元和 364.34 万元，占非流动资产的比例分别为 0.08%、0.23%和 0.33%。截至 2025 年末，长期待摊费用主要为装修工程费用。

(8) 递延所得税资产

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司递延所得税资产分别为 1,569.44 万元、1,753.99 万元和 3,382.88 万元，占非流动资产的比例分别为 1.90%、2.01%和 3.06%。截至 2025 年末，递延所得税资产主要由坏账准备、股份支付、可抵扣亏损、租赁负债、递延收益、预计负债、未实现内部损益等产生。

(9) 其他非流动资产

公司其他非流动资产主要为大额定期存单及利息。截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司其他非流动资产分别为 7,367.57 万元、7,511.71 万元和 20,368.27 万元，占非流动资产的比例分别为 8.93%、8.60%和 18.42%。报告期内，公司其他非流动资产呈上升趋势。2025 年末公司其他非流动资产较 2024 年末增加 12,856.56 万元，增幅为 171.15%，主要系期末大额定期存单及利息增加所致。

(二) 负债情况

1、负债的构成及分析

截至报告期各期末，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	30,384.07	73.68%	19,399.13	81.58%	11,000.82	81.87%
非流动负债	10,852.03	26.32%	4,380.83	18.42%	2,436.24	18.13%
负债总计	41,236.10	100.00%	23,779.97	100.00%	13,437.06	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 13,437.06 万元、23,779.97 万元和 41,236.10 万元。报告期内，公司负债总额整体较小。

2、流动负债的构成及分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	8,274.94	27.23%	5,426.28	27.97%	2,209.41	20.08%
预收款项	3.69	0.01%	3.64	0.02%	3.68	0.03%
合同负债	7,757.17	25.53%	5,625.30	29.00%	2,767.40	25.16%
应付职工薪酬	6,276.53	20.66%	4,463.43	23.01%	3,424.19	31.13%
应交税费	4,677.50	15.39%	2,503.05	12.90%	1,609.94	14.63%
其他应付款	808.13	2.66%	563.91	2.91%	464.10	4.22%
一年内到期的非流动负债	688.97	2.27%	407.31	2.10%	232.53	2.11%
其他流动负债	1,897.14	6.24%	406.22	2.09%	289.55	2.63%
流动负债合计	30,384.07	100.00%	19,399.13	100.00%	11,000.82	100.00%

报告期各期末，公司流动负债分别为 11,000.82 万元、19,399.13 万元和 30,384.07 万元，主要由应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费等经营性负债构成。报告期内，公司流动负债总额呈增长趋势，主要系随着公司业务规模增长，公司经营性流动负债金额同步增长所致。

（1）应付账款

报告期各期末，公司应付账款分别为 2,209.41 万元、5,426.28 万元和 8,274.94 万元，应付账款占流动负债的比例分别为 20.08%、27.97%和 27.23%。报告期内，公司应付账款余额随着公司业务发展和生产经营实际情况而波动。公司 2024 年末应付账款同比增加 3,216.87 万元，增幅为 145.60%，2025 年末应付账款同比增加 2,848.66 万元，增幅为 52.50%，主要系业务规模较同期扩大，应付款项增加所致。

报告期内公司与供应商建立了良好关系，从而能够获得供应商持续稳定的商业信用，有利于公司进行流动资金的整体筹划。

报告期内，各期末应付账款余额占当期营业成本比例的情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度
应付账款	8,274.94	5,426.28	2,209.41
营业成本	35,284.04	24,164.16	19,900.71

项目	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度
应付账款/营业成本	23.45%	22.46%	11.10%

公司2024年末应付账款占2024年营业成本比例有所上升，主要系2024年公司业务规模扩大，采购额增加，应付账款增加所致。

截至报告期各期末，公司应付账款账龄以1年以内为主，应付账款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内(含1年)	7,604.97	91.90%	4,855.30	89.48%	1,634.55	73.98%
1年以上	669.97	8.10%	570.98	10.52%	574.86	26.02%
合计	8,274.94	100.00%	5,426.28	100.00%	2,209.41	100.00%

截至报告期末，公司不存在5%（含5%）以上股东的应付款项。

（2）预收款项

截至2023年末、2024年末及2025年末，公司预收款项分别为3.68万元、3.64万元和3.69万元，占流动负债的比例分别为0.03%、0.02%和0.01%。报告期内，公司预收款项规模整体较小。

（3）合同负债

截至2023年末、2024年末及2025年末，公司合同负债分别为2,767.40万元、5,625.30万元和7,757.17万元，合同负债占公司流动负债的比例分别为25.16%、29.00%和25.53%。公司合同负债主要为销售预收款。2024年末公司合同负债较2023年末增加2,857.90万元，同比增幅103.27%，主要系公司销售额同比增长所致。2025年末公司合同负债较2024年末增加2,131.87万元，增幅为37.90%，主要系公司销售额增长所致。

（4）应付职工薪酬

截至2023年末、2024年末及2025年末，公司应付职工薪酬余额分别为3,424.19万元、4,463.43万元和6,276.53万元，占流动负债的比例分别为31.13%、23.01%和20.66%。报告期内，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期薪酬	6,107.31	97.30%	4,324.14	96.88%	3,320.70	96.98%
离职后福利-设定提存计划	169.22	2.70%	139.29	3.12%	102.01	2.98%
辞退福利	-	-	-	-	1.49	0.04%
合计	6,276.53	100.00%	4,463.43	100.00%	3,424.19	100.00%

公司 2024 年末应付职工薪酬相比于 2023 年末增加 1,039.24 万元，增幅为 30.35%，公司 2025 年末应付职工薪酬相比于 2024 年末增加 1,813.10 万元，增幅为 40.62%，主要系随着公司业务规模的增长，员工绩效增加所致。

(5) 应交税费

公司应交税费主要为增值税、企业所得税、个人所得税等。截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司应交税费分别为 1,609.94 万元、2,503.05 万元和 4,677.50 万元，占流动负债的比例分别为 14.63%、12.90%和 15.39%。报告期内，公司应交税费变动趋势与公司营业收入变动趋势保持一致。

(6) 其他应付款

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司其他应付款分别为 464.10 万元、563.91 万元和 808.13 万元，占流动负债的比例分别为 4.22%、2.91%和 2.66%。报告期内，公司其他应付款主要为应付预提费用和代扣代缴社保费，整体规模较小。

(7) 一年内到期的非流动负债

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司一年内到期的非流动负债分别为 232.53 万元、407.31 万元和 688.97 万元，占流动负债的比例分别为 2.11%、2.10%和 2.27%。报告期内，公司一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的租赁负债，整体规模较小。

(8) 其他流动负债

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司其他流动负债分别为 289.55 万元、406.22 万元和 1,897.14 万元，占流动负债的比例分别为 2.63%、2.09%和 6.24%。报告期内，公司其他流动负债主要为待转销项税和预提产品质量保证金。

3、非流动负债的构成及分析

截至报告期各期末，公司非流动负债构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	-	-	24.69	0.56%	-	-
租赁负债	1,651.02	15.21%	1,034.17	23.61%	76.28	3.13%
预计负债	-	-	903.86	20.63%	-	-
递延收益	5,842.00	53.83%	-	-	-	-
递延所得税负债	3,359.01	30.95%	2,418.11	55.20%	2,359.96	96.87%
非流动负债合计	10,852.03	100.00%	4,380.83	100.00%	2,436.24	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债分别为 2,436.24 万元、4,380.83 万元和 10,852.03 万元，主要由递延所得税负债、租赁负债、递延收益和预计负债构成。

（1）长期借款

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司长期借款余额分别为 0.00 万元、24.69 万元和 0.00 万元，均为保证借款。报告期内，公司长期借款金额和占比均较小。

（2）租赁负债

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司租赁负债分别为 76.28 万元、1,034.17 万元和 1,651.02 万元，占非流动负债的比例分别为 3.13%、23.61%和 15.21%。公司租赁负债主要由租赁房屋产生，房屋租赁情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（一）主要固定资产”之“3、房屋租赁情况”。

（3）预计负债

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司预计负债分别为 0.00 万元、903.86 万元和 0.00 万元，占非流动负债的比例分别为 0.00%、20.63%和 0.00%。2024 年末，公司预计负债的形成原因为计提产品质量保证金。

（4）递延收益

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司递延收益分别为 0.00 万元、0.00 万元和 5,842.00 万元，占非流动负债的比例分别为 0.00%、0.00%和 53.83%。公司递延收益为政府补助。

（5）递延所得税负债

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司递延所得税负债分别为 2,359.96 万元、2,418.11 万元和 3,359.01 万元，占非流动负债的比例分别为 96.87%、55.20%和 30.95%。公司递延所得税负债主要由其他权益工具投资和其他非流动金融资产公允价值变动产生。

（三）偿债能力分析

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
流动比率（倍）	11.17	15.13	24.01
速动比率（倍）	10.19	14.21	22.73
资产负债率（合并）	9.16%	6.24%	3.88%
资产负债率（母公司）	14.84%	11.90%	9.15%

注：各指标计算口径如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

1、偿债能力分析

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司流动比率分别为 24.01 倍、15.13 倍和 11.17 倍，速动比率分别为 22.73 倍、14.21 倍和 10.19 倍，合并报表层面资产负债率分别为 3.88%、6.24%和 9.16%。报告期内，公司流动比率、速动比率较高，资产负债率较低，整体流动性较好，资产负债结构合理。

2、偿债能力对比分析

报告期各期末，公司与可比上市公司的偿债能力指标比较情况如下：

项目		2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率(倍)	长川科技	1.90	1.80	2.12
	联动科技	9.81	14.28	11.63
	可比公司平均值	5.86	8.04	6.88
	公司	11.17	15.13	24.01

项目		2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
速动比率(倍)	长川科技	1.08	1.01	1.05
	联动科技	8.32	12.41	10.22
	可比公司平均值	4.70	6.71	5.64
	公司	10.19	14.21	22.73
资产负债率 (合并)	长川科技	51.03%	49.75%	41.20%
	联动科技	8.73%	6.13%	8.11%
	可比公司平均值	29.88%	27.94%	24.66%
	公司	9.16%	6.24%	3.88%

注1：数据源自各公司定期报告、同花顺 iFind。

报告期各期末，公司的流动比率和速动比率高于同行业可比上市公司平均水平，公司的资产负债率低于同行业可比上市公司平均水平，公司偿债能力较强。

（四）资产周转能力分析

项目	2025年度	2024年度	2023年度
应收账款周转率（次）	2.76	2.72	2.06
存货周转率（次）	1.45	1.48	1.19

注：各指标计算口径如下：

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额

存货周转率=营业成本/存货平均账面余额

1、资产周转能力分析

报告期各期末，公司应收账款周转率分别为 2.06、2.72 和 2.76。报告期内，公司应收账款整体回款良好。

报告期各期末，公司存货周转率分别为 1.19、1.48 和 1.45。报告期内，公司存货周转率整体保持稳定。

2、资产周转能力对比分析

报告期各期内，公司与可比上市公司的资产周转能力指标比较情况如下：

项目		2025年度	2024年度	2023年度
应收账款周转率 (次/年)	长川科技	2.85	2.70	1.70
	联动科技	2.07	2.91	2.92
	可比公司平均值	2.46	2.81	2.31

项目		2025 年度	2024 年度	2023 年度
	公司	2.76	2.72	2.06
存货周转率 (次/年)	长川科技	0.77	0.71	0.39
	联动科技	0.78	0.75	0.56
	可比公司平均值	0.78	0.73	0.47
	公司	1.45	1.48	1.19

注 1：数据源自各公司定期报告、同花顺 iFind。

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率均高于同行业可比上市公司平均水平。

（五）财务性投资

1、最近一期末公司持有财务性投资明细、持有原因及未来处置计划

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可转债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。”

根据中国证监会《证券期货法律适用意见第 18 号》，对财务性投资说明如下：

“（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（三）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（六）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。”

截至 2025 年 12 月 31 日，公司与财务性投资相关的各类报表项目情况如下：

单位：万元

项目	2025年末		未来拟实施的财务性投资金额	账面及拟实施财务性投资占2025年末归母净利润的比例
	账面价值	财务性投资金额		
交易性金融资产	11,812.01	11,812.01	-	2.90%
其他应收款	717.47	-	-	-
一年内到期的非流动资产	7,618.40	-	-	-
其他流动资产	7,056.40	-	-	-
其他权益工具投资	22,074.02	-	-	-
其他非流动金融资产	14,317.27	14,317.27	3,000.00	4.25%
其他非流动资产	20,368.27	-	-	-
合计	83,963.84	26,129.28	3,000.00	7.14%

（1）交易性金融资产

公司交易性金融资产为权益工具投资。截至 2025 年末，公司交易性金融资产余额为 11,812.01 万元，占归母净利润的比例为 2.90%。公司交易性金融资产为 2023 年 5 月参与上市公司芯联集成科创板 IPO 战略配售、2023 年 10 月参与思瑞浦向特定对象发行股票所持有的股票，被投资上市公司均为半导体产业链公司，且与公司存在业务往来。出于谨慎性考虑，公司将该等交易性金融资产认定为财务性投资。

截至目前，公司暂无对交易性金融资产的处置计划。

（2）其他应收款

截至 2025 年末，公司其他应收款账面价值 717.47 万元，主要为保证金及押金，不存在拆借资金、委托贷款等财务性投资性质的款项。

（3）一年内到期的非流动资产

截至 2025 年末，公司一年内到期的非流动资产的账面价值为 7,618.40 万元，主要为一年内到期的大额定期存单本金及利息，大额存单风险较低，系公司为充分利用闲置

资金、提升资金使用效率而购买的安全性较高、流动性较强、风险较低的金融产品，不属于财务性投资。

截至目前，公司对一年内到期的非流动资产拟持有至到期，无提前处置计划。

（4）其他流动资产

截至 2025 年末，公司其他流动资产账面价值 7,056.40 万元，主要为大额定期存单及利息、预缴所得税、待摊费用、应收出口退税款、留抵税额及待认证进项税额等。大额定期存单风险较低，系公司为充分利用闲置资金、提升资金使用效率而购买的安全性较高、流动性较强、风险较低的金融产品，不属于财务性投资。其他流动资产中，除大额定期存单及利息外，均为经营相关款项、税款等，不属于财务性投资。

截至目前，公司对其他流动资产中的大额定期存单拟持有至到期，无提前处置计划。

（5）其他权益工具投资

截至 2025 年末，公司其他权益工具投资账面价值为 22,074.02 万元，为对上海韬盛电子科技股份有限公司、江苏芯长征微电子集团股份有限公司、成都中科四点零科技有限公司、苏州联讯仪器股份有限公司、北京士模微电子有限责任公司等半导体产业链上下游相关公司的投资，与公司业务具有协同性，对上述公司的投资符合公司主营业务及战略发展方向，系围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。

截至目前，公司暂无对其他权益工具投资的处置计划。

（6）其他非流动金融资产

截至 2025 年末，公司其他非流动金融资产账面价值为 14,317.27 万元，为对广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）、南京武岳峰汇芯创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）等半导体产业基金的投资，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	
	金额	占比
广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）	6,403.39	44.72%
南京武岳峰汇芯创业投资合伙企业（有限合伙）	4,500.97	31.44%
合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）	3,412.91	23.84%

项目	2025年12月31日	
	金额	占比
合计	14,317.27	100.00%

自本次发行董事会决议日前六个月（2024年7月24日）至今，公司于2024年12月对广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）出资1,500.00万元，于2025年3月对合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）出资1,500.00万元，于2025年8月对南京武岳峰汇芯创业投资合伙企业（有限合伙）出资500.00万元，于2026年1月对合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）出资2,000.00万元。

由于南京武岳峰汇芯创业投资合伙企业（有限合伙）存在尚未实缴出资部分，故公司未来拟实施的财务性投资金额为1,000.00万元。

该等投资与公司的业务具有一定的协同性，对上述公司的投资为符合公司主营业务及战略发展方向的产业投资。但出于谨慎性考虑，公司将该等其他非流动金融资产认定为财务性投资。

公司已于2025年6月9日召开第三届董事会第十二次会议，将上述自本次发行董事会决议日前六个月（2024年7月24日）至今，公司实施的财务性投资和拟实施的财务性投资（合计6,500.00万元）从本次募集资金总额中扣除。

截至目前，公司暂无对其他非流动金融资产的处置计划。

（7）其他非流动资产

截至2025年末，公司其他非流动资产账面价值为20,368.27万元。公司其他非流动资产主要为大额定期存单及利息。大额定期存单风险较低，系公司为充分利用闲置资金、提升资金使用效率而购买的安全性较高、流动性较强、风险较低的金融产品，不属于财务性投资。

截至目前，公司对其他非流动资产拟持有至到期，无提前处置计划。

综上所述，公司最近一期末财务性投资金额为26,129.28万元，未来拟实施的财务性投资金额3,000.00万元，合计占归属于母公司股东净资产的比例为7.14%，不超过30%。公司已于2025年6月9日召开第三届董事会第十二次会议，将自本次发行董事会决议日前六个月（2024年7月24日）至今，公司实施的财务性投资和拟实施的财务性投资

（合计 6,500.00 万元）从本次募集资金总额中扣除。公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。截至本募集说明书签署日，公司对于财务性投资暂无未来处置计划。

2、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过本次向不特定对象发行可转债的相关事项。自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今（即自 2024 年 7 月 24 日至今），公司实施的财务性投资为 2024 年 12 月对广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）出资 1,500.00 万元、2025 年 3 月对合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）出资 1,500.00 万元、2025 年 8 月对南京武岳峰汇芯创业投资合伙企业（有限合伙）出资 500.00 万元、2026 年 1 月对合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）出资 2,000.00 万元；公司拟实施的财务性投资为按照协议约定缴纳南京武岳峰汇芯创业投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资余额 1,000.00 万元。上述合计 6,500.00 万元。

公司已于 2025 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，将上述自本次发行董事会决议日前六个月（2024 年 7 月 24 日）至今，公司实施的财务性投资和拟实施的财务性投资（合计 6,500.00 万元）从本次募集资金总额中扣除。

自本次发行董事会决议日前六个月（2024 年 7 月 24 日）至今，公司不存在实施或拟实施类金融业务的情形。具体分析如下：

（1）类金融业务

公司是国内最早进入半导体测试设备行业的企业之一，深耕半导体测试三十多年，是国内具有竞争力的半导体测试设备本土供应商，不属于类金融机构，未进行类金融业务。

（2）投资产业基金、并购基金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，除按原合同约定履行出资义务外，公司不存在投资产业基金、并购基金的情形。

（3）拆借资金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在资金拆借情况。

（4）委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在将资金以委托贷款的形式借予他人的情况。

(5) 以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资情形。

(6) 购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

(7) 非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资金融业务的情况。

综上所述，截至报告期末，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。公司已于 2025 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，将自本次发行董事会决议日前六个月（2024 年 7 月 24 日）至今，公司实施的财务性投资和拟实施的财务性投资（合计 6,500.00 万元）从本次募集资金总额中扣除。

七、经营成果分析

（一）营业收入分析

1、营业收入的整体变化情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	134,008.49	99.53%	90,118.60	99.54%	68,754.20	99.52%
其他业务收入	632.57	0.47%	415.94	0.46%	331.99	0.48%
合计	134,641.06	100.00%	90,534.54	100.00%	69,086.19	100.00%

报告期各期，公司主营业务收入分别为 68,754.20 万元、90,118.60 万元和 134,008.49 万元，报告期内占营业收入的比例均超过 99%。

2、主营业务收入按产品类型分析

报告期内，公司按照产品类型划分的主营业务收入构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
测试系统	118,735.82	88.60%	81,497.87	90.43%	59,262.18	86.19%
测试系统配件	15,272.67	11.40%	8,620.73	9.57%	9,492.02	13.81%
合计	134,008.49	100.00%	90,118.60	100.00%	68,754.20	100.00%

报告期内，公司主营业务收入由测试系统和测试系统配件的销售收入构成。

2024 年，公司主营业务收入同比增长 31.07%，2025 年，公司主营业务收入同比增长 48.70%，主要系随着 AI 等创新技术的发展，带动了工业、通讯和消费电子市场的复苏，公司的订单逐步出现回暖，公司业绩企稳回升。

3、主营业务收入按销售区域分析

报告期内，公司主营业务收入按销售区域分布如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	124,783.36	93.12%	84,535.39	93.80%	59,957.46	87.21%
境外	9,225.13	6.88%	5,583.22	6.20%	8,796.75	12.79%
合计	134,008.49	100.00%	90,118.60	100.00%	68,754.20	100.00%

报告期内，公司境外收入受市场环境变化而变化。

4、营业收入季节性变动情况

报告期内，公司营业收入季节性变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一季度	19,765.19	14.68%	13,682.32	15.11%	20,005.90	28.96%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
二季度	33,680.41	25.01%	24,225.01	26.76%	18,143.03	26.26%
三季度	40,485.99	30.07%	24,212.53	26.74%	13,724.37	19.87%
四季度	40,709.48	30.24%	28,414.68	31.39%	17,212.89	24.92%
合计	134,641.06	100.00%	90,534.54	100.00%	69,086.19	100.00%

报告期内，发行人各季度实现的收入具有一定波动，主要受到下游半导体行业产能投入计划、客户验收周期、行业周期性波动等因素的影响。

（二）营业成本分析

1、营业成本的整体变化情况

报告期内，公司营业成本构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	35,099.51	99.48%	23,984.18	99.26%	19,724.67	99.12%
其他业务成本	184.53	0.52%	179.97	0.74%	176.04	0.88%
合计	35,284.04	100.00%	24,164.16	100.00%	19,900.71	100.00%

报告期各期，发行人营业成本分别为 19,900.71 万元、24,164.16 万元及 35,284.04 万元，与营业收入变动趋势保持一致。

2、主营业务成本按产品类型分析

报告期内，公司按照产品类型划分的主营业务成本构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
测试系统	30,907.40	88.06%	21,777.89	90.80%	17,065.41	86.52%
测试系统配件	4,192.11	11.94%	2,206.29	9.20%	2,659.26	13.48%
合计	35,099.51	100.00%	23,984.18	100.00%	19,724.67	100.00%

报告期内，公司主营业务成本构成与其主营业务收入构成基本一致，变动趋势基本匹配。

3、主营业务成本按成本类型分析

报告期内，公司主营业务成本分成本类型构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
测试系统	30,907.40	88.06%	21,777.89	90.80%	17,065.41	86.52%
原材料	26,392.60	75.19%	17,954.88	74.86%	13,212.96	66.99%
人工	1,720.73	4.90%	1,462.62	6.10%	1,237.59	6.27%
制造费用	2,794.07	7.96%	2,360.39	9.84%	2,614.86	13.26%
测试系统配件	4,192.11	11.94%	2,206.29	9.20%	2,659.26	13.48%
原材料	3,663.32	10.44%	1,877.22	7.83%	2,171.18	11.01%
人工	180.78	0.52%	119.83	0.50%	191.55	0.97%
制造费用	348.01	0.99%	209.24	0.87%	296.54	1.50%
合计	35,099.51	100.00%	23,984.18	100.00%	19,724.67	100.00%

报告期内，公司主营业务成本包括原材料、人工和制造费用，其中原材料构成营业成本的主要部分。

（三）毛利率分析

1、毛利结构分析

报告期内，公司营业毛利情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	98,908.99	99.55%	66,134.42	99.64%	49,029.53	99.68%
其他业务毛利	448.04	0.45%	235.96	0.36%	155.94	0.32%
合计	99,357.02	100.00%	66,370.38	100.00%	49,185.47	100.00%

报告期内，公司毛利基本来自主营业务。2023 年度、2024 年度及 2025 年度，公

司主营业务毛利分别为 49,029.53 万元、66,134.42 万元及 98,908.99 万元，变动趋势与公司主营业务收入基本保持一致。

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
测试系统	87,828.42	88.80%	59,719.97	90.30%	42,196.77	86.06%
测试系统配件	11,080.56	11.20%	6,414.44	9.70%	6,832.76	13.94%
总计	98,908.99	100.00%	66,134.42	100.00%	49,029.53	100.00%

2、毛利率分析

报告期内，公司毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
主营业务毛利	98,908.99	73.81%	66,134.42	73.39%	49,029.53	71.31%
其他业务毛利	448.04	70.83%	235.96	56.73%	155.94	46.97%
合计	99,357.02	73.79%	66,370.38	73.31%	49,185.47	71.19%

报告期内，公司综合毛利率分别为 71.19%、73.31%和 73.79%。2024 年，随着 AI 等创新技术的发展，带动了工业、通讯和消费电子市场的复苏，公司生产销售数量上升，以及产品规格型号比例变动导致公司毛利率同比有所提高。2025 年，公司毛利率整体保持稳定。

报告期内，公司各类业务毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
测试系统	87,828.42	73.97%	59,719.97	73.28%	42,196.77	71.20%
测试系统配件	11,080.56	72.55%	6,414.44	74.41%	6,832.76	71.98%
总计	98,908.99	73.81%	66,134.42	73.39%	49,029.53	71.31%

3、发行人毛利率与同行业上市公司毛利率比较

同行业上市公司同类型业务毛利率水平如下表所示：

上市公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
长川科技-测试机	62.25%	66.61%	70.16%
联动科技-半导体自动化测试系统	55.28%	56.41%	62.04%
可比公司平均值	58.77%	61.51%	66.10%
公司	73.79%	73.31%	71.19%

资料来源：同花顺 iFind。

报告期内，公司综合毛利率水平高于同期可比公司平均水平。长川科技测试机业务报告期各期毛利率分别为 70.16%、66.61%和 62.25%，联动科技报告期内半导体自动化测试系统毛利率分别为 62.04%、56.41%和 55.28%，长川科技测试机业务与公司毛利率水平较为接近。公司毛利率高于联动科技半导体自动化测试系统毛利率，主要原因为公司产品技术水平、产品配置更高所致。

（四）利润主要来源及经营成果变化分析

报告期内，公司利润表主要项目构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	134,641.06	90,534.54	69,086.19
减：营业成本	35,284.04	24,164.16	19,900.71
税金及附加	1,388.92	1,160.65	852.87
销售费用	15,682.34	12,844.83	10,508.10
管理费用	6,513.00	5,794.07	5,452.08
研发费用	26,571.67	17,236.82	13,198.02
财务费用	-3,519.86	-5,117.62	-5,143.34
其中：利息费用	84.99	39.66	20.82
利息收入	4,439.16	4,697.67	4,647.66
加：其他收益	2,349.30	3,825.16	2,370.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	171.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,605.23	-1,232.10	-303.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,179.80	-882.27	44.70

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-174.32	-93.48	-72.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5.17	2.03	1.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,316.20	36,070.96	26,529.33
加：营业外收入	14.31	67.92	30.66
减：营业外支出	11.95	16.40	0.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,318.56	36,122.49	26,559.43
减：所得税费用	4,708.96	2,731.00	1,394.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,609.61	33,391.48	25,165.23
归属于母公司股东的净利润	53,609.61	33,391.48	25,165.23

1、营业收入分析

报告期内，公司营业收入的变动情况及分析参见本节之“七、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”的相关内容。

2、营业成本分析

报告期内，公司营业成本的变动情况及分析参见本节之“七、经营成果分析”之“（二）营业成本分析”的相关内容。

3、期间费用分析

（1）期间费用整体占比及变动情况

报告期内，公司各项期间费用金额及其占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
销售费用	15,682.34	11.65%	12,844.83	14.19%	10,508.10	15.21%
管理费用	6,513.00	4.84%	5,794.07	6.40%	5,452.08	7.89%
研发费用	26,571.67	19.74%	17,236.82	19.04%	13,198.02	19.10%
财务费用	-3,519.86	-2.61%	-5,117.62	-5.65%	-5,143.34	-7.44%
合计	45,247.15	33.61%	30,758.10	33.97%	24,014.87	34.76%

公司期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用及财务费用，报告期内，公司期

间费用分别为 24,014.87 万元、30,758.10 万元和 45,247.15 万元，占营业收入的比例分别为 34.76%、33.97%和 33.61%。随着公司持续加大市场推广，公司销售费用报告期内呈上升趋势；公司管理费用随着业务规模扩大有所增长；随着公司加大研发投入，报告期内公司研发费用有所提高；公司财务费用随存款类产品的利息收入和汇兑损益变化而变化。

（2）销售费用

报告期内，公司各期销售费用主要项目及所占比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	9,577.66	61.07%	7,926.42	61.71%	5,960.61	56.72%
股份支付	599.99	3.83%	247.76	1.93%	414.78	3.95%
市场调研及服务费	1,770.68	11.29%	1,454.18	11.32%	1,932.35	18.39%
交通差旅费	1,177.11	7.51%	1,125.29	8.76%	873.34	8.31%
业务招待费	475.51	3.03%	387.04	3.01%	210.40	2.00%
折旧费	1,184.48	7.55%	952.53	7.42%	731.87	6.96%
运输费	85.53	0.55%	83.29	0.65%	56.12	0.53%
业务宣传费	104.89	0.67%	155.15	1.21%	41.78	0.40%
办公费	192.68	1.23%	145.55	1.13%	56.27	0.54%
租赁费	78.79	0.50%	94.66	0.74%	20.59	0.20%
物业及水电费	163.78	1.04%	83.10	0.65%	71.87	0.68%
其他费用	271.23	1.73%	189.86	1.48%	138.14	1.31%
合计	15,682.34	100.00%	12,844.83	100.00%	10,508.10	100.00%
销售费用率	11.65%	-	14.19%	-	15.21%	-

公司销售费用主要由职工薪酬、市场调研及服务费、交通差旅费和折旧费等构成。报告期内公司销售费用分别为 10,508.10 万元、12,844.83 万元及 15,682.34 万元，占营业收入的比例分别是 15.21%、14.19%及 11.65%。报告期内，随着公司持续加大市场推广，销售费用相应增加。

（3）管理费用

报告期内，公司各期管理费用主要项目及所占比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	4,106.20	63.05%	3,839.45	66.27%	3,471.46	63.67%
股份支付	671.17	10.31%	442.02	7.63%	701.21	12.86%
交通差旅费	84.86	1.30%	86.98	1.50%	70.23	1.29%
业务招待费	77.79	1.19%	73.22	1.26%	70.08	1.29%
租赁费	61.53	0.94%	37.50	0.65%	27.65	0.51%
物业及水电费	118.59	1.82%	116.90	2.02%	117.59	2.16%
折旧费	406.67	6.24%	464.52	8.02%	434.83	7.98%
无形资产摊销	79.36	1.22%	73.68	1.27%	68.06	1.25%
长期待摊费用摊销	24.88	0.38%	30.43	0.53%	45.09	0.83%
外部咨询及中介机构服务费	443.87	6.82%	382.68	6.60%	243.11	4.46%
办公费	208.59	3.20%	142.27	2.46%	144.89	2.66%
其他费用	229.49	3.52%	104.41	1.80%	57.89	1.06%
合计	6,513.00	100.00%	5,794.07	100.00%	5,452.08	100.00%
管理费用率	4.84%	-	6.40%	-	7.89%	-

公司管理费用以职工薪酬为主，另包含股份支付、折旧摊销费、交通差旅费等。报告期内，公司管理费用分别为 5,452.08 万元、5,794.07 万元及 6,513.00 万元，占营业收入的比例分别为 7.89%、6.40%和 4.84%。报告期内，公司管理费用随着业务规模扩大有所增长。

（4）研发费用

报告期内，公司各期研发费用主要项目及所占比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	20,714.17	77.96%	13,824.42	80.20%	9,929.57	75.24%
股份支付	887.09	3.34%	269.14	1.56%	570.91	4.33%
委托外部单位开发费	162.41	0.61%	61.93	0.36%	165.09	1.25%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料费	2,389.95	8.99%	1,122.59	6.51%	1,020.62	7.73%
折旧费	1,173.13	4.41%	981.85	5.70%	800.45	6.06%
水电费	328.74	1.24%	248.67	1.44%	221.00	1.67%
其他费用	916.17	3.45%	728.21	4.22%	490.38	3.72%
合计	26,571.67	100.00%	17,236.82	100.00%	13,198.02	100.00%
研发费用率	19.74%	-	19.04%	-	19.10%	-

公司研发费用主要由职工薪酬、材料费和折旧费等组成。报告期内，公司研发费用分别为 13,198.02 万元、17,236.82 万元及 26,571.67 万元，公司的研发投入不断加大，总体呈上升趋势。报告期内，公司研发费用占营业收入的比重分别为 19.10%、19.04% 和 19.74%。

(5) 财务费用

报告期内，公司各期财务费用主要项目情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息费用	84.99	39.66	20.82
减：利息收入	4,439.16	4,697.67	4,647.66
汇兑损益	816.23	-474.96	-531.55
手续费支出	18.07	15.36	15.04
合计	-3,519.86	-5,117.62	-5,143.34
财务费用率	-2.61%	-5.65%	-7.44%

报告期内，公司财务费用分别为-5,143.34 万元、-5,117.62 万元及-3,519.86 万元，占营业收入的比重分别为-7.44%、-5.65%和-2.61%。报告期内，公司财务费用随存款类产品的利息收入和汇兑损益变化而变化。

4、其他收益

报告期内，公司取得的其他收益金额分别为 2,370.29 万元、3,825.16 万元及 2,349.30 万元，主要是即征即退和加计扣除的增值税等。报告期内，公司其他收益项目情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
增值税即征即退	580.02	1,759.00	2,145.16
增值税加计扣除	1,187.58	1,612.07	124.37
政府补助	552.35	386.54	53.59
代扣个人所得税及附加税手续费返还	29.32	67.56	47.18
其他	0.02	-	-
合计	2,349.30	3,825.16	2,370.29

5、投资收益

报告期内，公司取得投资收益金额分别为 171.93 万元、0.00 万元及 0.00 万元，主要为处置交易性金融资产产生的投资收益和其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入。投资收益明细情况如下表。

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
处置交易性金融资产产生的投资收益	-	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-	171.93
合计	-	-	171.93

6、信用减值损失

公司将应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款计提的坏账准备计入信用减值损失。报告期内主要信用减值损失是对应收票据和应收账款计提的减值损失，具体情况及分析参见本节之“六、财务状况分析”之“（一）资产情况”之“2、流动资产的构成及分析”之“（3）应收票据”和“（4）应收账款”的相关内容。

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收票据坏账损失	-96.37	32.26	-32.64
应收账款坏账损失	-1,067.70	-904.50	82.36
其他应收款坏账损失	-15.73	-10.03	-5.02
合计	-1,179.80	-882.27	44.70

7、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失主要是存货跌价损失，具体情况及分析参见本节之“六、财务状况分析”之“（一）资产情况”之“2、流动资产的构成及分析”之“（7）存货”的相关内容。

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失	-166.59	-88.36	-67.59
合同资产减值损失	-7.73	-5.12	-5.08
合计	-174.32	-93.48	-72.67

8、资产处置收益

报告期内，公司取得的资产处置收益金额分别为 1.24 万元、2.03 万元和 -5.17 万元，整体金额较小。

9、营业外收入和营业外支出

（1）营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	-	28.18	27.43
非同一控制下企业合并产生的负商誉	-	28.30	-
其他	14.31	11.45	3.22
合计	14.31	67.92	30.66

报告期内，公司的营业外收入规模整体较低。

（2）营业外支出

报告期各期间，公司营业外支出金额分别为 0.56 万元、16.40 万元及 11.95 万元，整体金额较低。

(五) 非经常性损益情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-9.43	1.66	0.93
2. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	552.35	414.72	81.02
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,605.23	-1,232.10	-303.90
4. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	28.30	-
5. 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	-
6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6.62	-4.58	2.98
7. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	29.35	67.56	47.18
减：所得税影响额	778.17	-111.20	-26.17
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
合计	4,405.96	-613.26	-145.63

报告期内，公司非经常性损益分别为-145.63万元、-613.26万元及4,405.96万元。公司非经常性损益主要构成项目为计入当期损益的政府补助、持有金融资产产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益等。

(六) 纳税情况**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按6%、10%[注]、13%等税率计缴，出口货物执行“免、退”税和“免、抵、退”税政策。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、20%、24%、25%、17%、21%、23.2%

注：AccoTEST Technology Japan 株式会社销售货物或提供应税劳务以纳税人的总销货额与总进货额的差额为计税依据计征日本消费税，税率为 10%，日本消费税是基于商品或服务的增值而征税的一种间接税，故作为增值税列示。

截至 2025 年 12 月 31 日，不同企业所得税税率纳税主体情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
北京华峰测控技术股份有限公司	15%
华峰测控技术（天津）有限责任公司	15%
北京华峰装备技术有限公司	25%
福州华峰	20%
上海华峰	20%
爱格测试技术有限公司	8.25%(16.5%，中国香港 200 万元利润税率以内为 8.25%)
ACCOTEST TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.	24%
ACCOTEST ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD.	24%
ACCOTEST TECHNOLOGY(USA),INC	21%
新加坡华峰	17%
AccoTEST Technology Japan 株式会社	23.2%

2、税收优惠

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100 号文的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按规定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

根据财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知（财税〔2023〕17 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳增值税税额，公司及子公司华峰测控技术（天津）有限责任公司及北京华峰装备技术有限公司享受该政策。

（2）企业所得税

公司于 2023 年 10 月 26 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务

总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号：GR202311003282，有效期三年），适用 15%的企业所得税税率。

公司子公司华峰测控技术（天津）有限责任公司于 2023 年 12 月 8 日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号：GR202312002022，有效期三年），适用 15%的企业所得税税率。

根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）规定，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税的政策。公司子公司北京华峰装备技术有限公司适用该优惠政策。

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，“对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。福州华峰、上海华峰适用该优惠政策。

八、现金流量分析

（一）经营活动现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	129,124.18	84,919.44	83,894.00
收到的税费返还	2,237.01	2,913.01	3,705.23
收到其他与经营活动有关的现金	8,913.15	1,801.72	3,680.07
经营活动现金流入小计	140,274.35	89,634.17	91,279.30
购买商品、接受劳务支付的现金	52,705.83	28,379.05	19,504.83
支付给职工以及为职工支付的现金	34,942.54	26,469.32	21,287.33
支付的各项税费	13,851.54	9,962.51	11,575.29
支付其他与经营活动有关的现金	8,354.34	6,013.56	6,763.25
经营活动现金流出小计	109,854.26	70,824.44	59,130.69

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	30,420.08	18,809.73	32,148.61

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 32,148.61 万元、18,809.73 万元和 30,420.08 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金分别为 83,894.00 万元、84,919.44 万元和 129,124.18 万元。报告期内，公司经营活动现金流量净额始终保持正向流入，公司经营活动产生的现金流情况较好，体现了公司整体良好的经营态势。

（二）投资活动现金流

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	24,027.20	6,532.24	1,248.30
取得投资收益收到的现金	2,669.49	3,233.46	2,493.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.35	3.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	18,302.67	9,183.90	-
投资活动现金流入小计	45,005.71	18,952.60	3,741.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,618.70	3,081.60	2,547.18
投资支付的现金	41,563.93	8,164.64	18,681.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,901.38	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	7,847.90
投资活动现金流出小计	50,084.01	11,246.24	29,076.75
投资活动产生的现金流量净额	-5,078.30	7,706.35	-25,335.42

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-25,335.42 万元、7,706.35 万元和-5,078.30 万元。2024 年度，公司投资活动产生的现金流量净额由负转正，主要系收回投资收到的现金、收到其他与投资活动有关的现金增多，同时支付其他与投资活动有关的现金减少所致。2025 年，公司投资活动产生的现金流量净额由正转负，主要系投资支付的现金大于收回投资收到的现金所致。

（三）筹资活动现金流

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	986.65	488.55	2,759.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	986.65	488.55	2,759.00
偿还债务支付的现金	40.53	57.17	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,145.35	10,682.43	12,750.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	752.46	1,983.36	278.09
筹资活动现金流出小计	10,938.34	12,722.97	13,028.39
筹资活动产生的现金流量净额	-9,951.69	-12,234.42	-10,269.39

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-10,269.39 万元、-12,234.42 万元和-9,951.69 万元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额持续为负，主要系现金分红所致。

九、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 2,547.18 万元、3,081.60 万元和 6,618.70 万元。

2025 年 12 月，公司购买了福州华峰百分之八十的股权，股权取得成本为 4,000.00 万元。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求情况

截至本募集说明书出具日，未来可预见的重大资本性支出为本次募集资金投资项目，具体情况详见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”的有关内容。

（三）重大资本性支出与科技创新之间的关系

关于重大资本性支出与科技创新之间的关系，具体参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务”。

十、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

技术方面，公司在模拟、混合、功率和 SoC 领域突破了多项关键核心技术，已成功开发高可靠、高精度、高效率的测试系统，装机量逐年攀升。截至 2025 年 12 月 31 日，全球装机量已经突破 8,000 台。目前，公司是为数不多向国内外知名芯片设计公司、晶圆厂、IDM 和封测厂商供应半导体测试系统的中国企业。

公司成立至今，一直坚持在产品技术创新和研发方面保持高强度的投入，经过三十多年的研发投入和技术迭代，公司拥有模拟、数模混合、射频、SoC、存储器、分立器件、功率模块等测试领域的诸多核心技术，包括 V/I 源、精密电压电流测量、高速数字波形发生与采集、射频及混合器件测试、存储器件测试、宽禁带半导体测试和智能功率模块测试等。同时密切跟踪半导体行业的发展方向，不断为客户推出功能更全、精度更高、速度更快的测试系统。

（二）正在从事的研发项目及进展情况

截至报告期末，公司正在从事的研发项目共 6 个，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	2025年度投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	模拟和混合测试系统	2,295.70	446.18	1,285.20	量产	研发适用于模拟和混合类集成电路测试系统	国内具有竞争优势	主要应用于模拟和混合类集成电路测试
2	混合和 PMIC 测试系统	25,234.30	1,072.01	17,670.61	量产	研发适用于混合类和 PMIC 类集成电路测试系统	国内具有竞争优势	主要应用于混合类和 PMIC 类集成电路测试
3	大规模 SoC 测试系统	56,903.10	20,325.62	31,674.57	客户验证	研发适用于 SoC 类集成电路测试系统	国内具有竞争优势	主要应用于大规模 SoC 芯片（包括高速数字电路、高性能混合电路、微波/射频电路、通讯接口电路、

序号	项目名称	预计总投资规模	2025年度投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
								CPU 芯片等) 的测试
4	大功率高速测试系统	21,129.20	1,943.19	17,377.36	量产	研发适用于功率类集成电路测试	国内具有竞争优势	主要应用于功率类集成电路测试
5	高速通讯系统和软件	37,469.43	2,534.62	21,385.13	量产	为公司现有的测试系统提供技术支持	国内具有竞争优势	主要应用于模拟、功率、混合和 SoC 类集成电路测试
6	元器件智能化筛选和测试系统	6,665.00	250.06	3,833.05	量产	研发适用于元器件测试筛选设备及专用智能化测试系统	国内具有竞争优势	主要应用于元器件智能化筛选和测试
合计	/	149,696.73	26,571.67	93,225.92	/	/	/	/

(三) 保持持续技术创新的机制和安排

1、研发机制

公司研发部总体负责技术研发工作，研发部下设功率产品线、混合产品线、SoC 产品线及公共资源部四个分支：

研发部分支	职责与定位
功率产品线	主要针对功率半导体器件（如 IGBT、大功率模块以及新型氮化镓、碳化硅器件）的测试需求，开发出具备高压、大电流、高安全性与高可靠性的测试系统，突破传统分立器件的测试方式，顺应功率器件向模块化和集成化发展的趋势
混合产品线	针对混合/模拟集成电路的测试需求，通过开发高精度信号采集、精密电压与电流测量技术，以及模块化测试方案，研发出模拟/混合测试系统，确保公司产品在测试速度和精度上达到国内较高水平
SoC 产品线	主要面向系统级芯片（SoC）的测试需求，通过研发高速数字通道、高并发测试技术及全新软件平台，打造满足 SoC 高通道数、高测试频率、高功耗及高集成度要求的全新一代测试系统，力图打破国外在该领域的垄断
公共资源部	作为公司三条产品线的共享服务平台，为各产品线提供 PCB、器件、软件、逻辑、结构和系统硬件等全方位技术支持，针对不同技术需求提供共性支持，实现研发资源利用最大化。此外，公共资源部还设有基础实验室，专注于前沿技术的追踪与研究。密切关注行业最新动态，深入研究新兴技术，为各产品线提供前瞻性的技术储备和创新思路，助力公司保持竞争优势

研发部各分支分工明确又紧密协作，共同推动公司在半导体测试领域的技术创新与产品研发，为公司的持续发展奠定坚实基础，并调动多部门配合研发工作：

(1) 总经理办公会负责研发立项的决策与审批工作，将下属产品决策委员会作为

执行机构。待公司就战略方向定义达成共识后，由产品决策委员会确认并输出相关成果；

(2) 由内部技术权威人员组成的公司产品相关委员会负责新研发立项的技术审查，具体工作由市场部牵头；

(3) 研发部和质量部等部门负责实际的研发和验证工作，研发部下属的基础实验室作为技术前瞻性支撑部门；

(4) 市场和服务部负责新产品市场需求的调研、试销和市场信息收集，协助研发部门进行项目建议书收集及研发过程中的日常事务性工作；

(5) 人力行政部和财务部负责立项登记；

(6) 首席技术专家负责知识产权的登记、申报和管理。

2、创新制度安排

公司高度重视专业技术人才培育，对技术团队采用扁平化管理模式，鼓励优秀技术人员主导新产品领域的技术平台搭建，在资金、团队组建、装备配置等方面给予充分支持。同时，公司为技术团队构建独立的技术职务体系，为技术人员开辟持续晋升通道。公司持续扩充研发团队规模，推行员工股权激励机制，充分激发员工创新的积极性。

公司注重员工培训，优化人才培养方案，积极开展线上线下培训活动，完善人才培养体系建设、规范内部培训管理和专业技术分享交流体系。为推动企业产学研深度融合，公司在天津子公司设立了博士后科研工作站，并与天津大学、清华大学电子工程系天津研究院达成合作关系。公司将坚持促进技术创新与制度创新、组织创新、管理创新以及文化创新的有机结合，增强公司技术创新能力，实现公司长远发展。

十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项及重要期后事项

(一) 重大担保事项

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未了结的或可预见的对外担保。

(二) 重大仲裁、诉讼及其他或有事项

截至2025年12月31日，公司及其子公司存在尚未了结的仲裁事项，截至本募集说明书出具日，案件进展更新如下：

序号	申请人	被申请人	案号	案由	涉案金额	仲裁阶段
1	北京业 永兴建 集团有 限公司	华峰测控 技术（天 津）有限 责任公司	TJDP20240093	施工合 同争议	503.23万元	2024年11月29日被申请人天津华峰提交仲裁反请求申请； 2025年2月14日，中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心首次开庭审理； 2025年4月7日，中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心第二次开庭审理； 2025年5月12日，中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心确定了本案的鉴定机构，并组织双方对鉴定资料进行质证。 2026年4月20日，中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心再次开庭审理此案。此案裁决作出的期限被延长至2026年6月13日。
2	北京业 永兴建 集团有 限公司	华峰测控 技术（天 津）有限 责任公司	TJDP20240094	施工合 同争议	131.51万元	2024年11月29日被申请人天津华峰提交仲裁反请求申请； 2025年2月14日，中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心首次开庭审理； 2025年4月7日，中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心第二次开庭审理； 2025年5月12日，中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心确定了本案的鉴定机构，并组织双方对鉴定资料进行质证。 2026年4月20日，中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心再次开庭审理此案。此案裁决作出的期限被延长至2026年6月13日。

上述2个案件的争议焦点仅为工程尾款的结算，涉案工程已完成竣工验收，并实际投入使用。因此，公司虽然存在尚未了结的仲裁案件，但是不属于对公司生产经营、财务状况、未来发展产生较大影响的重大诉讼、仲裁案件，不会对公司的持续经营产生重大不利影响，除此之外也不存在其他尚未了结的或可预见的对公司生产经营、财务状况、未来发展产生较大影响的未决诉讼、仲裁等事项。

综上，截至2025年12月31日，公司不存在重大未决诉讼或仲裁事项，公司不存在其他或有事项。

（三）重大期后事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在需要披露的重大期后事项。

（四）其他重大事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在其他对公司财务状况、盈利能力及持续经营产生影响的重大事项。

十二、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次向不特定对象发行可转债募集资金到位后，公司的货币资金、总资产和总负债规模将相应增加，可为公司的后续发展提供有力保障。本次可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转债持有人未来陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

本次发行募集资金到位后，可能短期内会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定幅度摊薄，但本次可转债募集资金投资项目符合国家产业政策要求和行业市场发展趋势，随着本次募投项目效益的实现，公司长期盈利能力将会得到显著增强，经营业绩预计会有一定程度的提升。

截至 2025 年末，公司无存续债券，公司合并口径净资产为 408,839.44 万元，本次发行募集资金总额不超过 74,947.50 万元（含本数）。本次发行完成后，累计债券余额为不超过 74,947.50 万元，不超过最近一期末净资产的 50%。

本次发行不涉及资产整合情况。

（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化

本次发行的募集资金投资项目建成后，有利于公司进一步提升生产能力，满足市场需求，深化公司发展战略，提升自动化生产水平，有利于公司保持并进一步提升自身的研发实力和科技创新能力。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行完成后，公司股权结构未发生重大变更，亦不会对控股股东控股地位造成影响，不会导致上市公司控制权发生变化。

第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投资项目计划

（一）项目基本情况

发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币74,947.50万元（含），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目	75,888.00	74,947.50
	合计	75,888.00	74,947.50

上述募集资金使用计划已经发行人第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十二次会议审议，如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，发行人董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，发行人董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，发行人将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

（二）项目备案或审批情况

发行人本次拟实施的募投项目所履行的审批/备案情况如下表所示：

募投项目	实施主体	备案手续	环评手续
基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目	华峰测控	京海科信局备[2025]138号	不涉及环境影响评价备案
	天津华峰	津生固投发（2025）47号	

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目

1、项目基本情况

为顺应行业发展趋势，公司拟加强在 ASIC 芯片方面的研发。本项目建成后，公司将具备测试系统的核心 ASIC 定义及架构设计能力，并以此构建长期稳定和可靠的测试系统核心 ASIC 供应链，打造全新一代基于自研 ASIC 芯片的国产化测试系统，减少对外部专用芯片供应商资源的依赖，提升公司核心竞争力。

项目名称	基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目
实施主体	华峰测控、天津华峰
项目总投资	75,888.00 万元
拟投入募集资金	74,947.50 万元
项目实施地点	北京市海淀区丰豪东路 9 号院、天津市滨海新区中新天津生态城川博道 1201 号，拟利用现有建筑和新增租赁办公楼进行项目建设，总建筑面积为 3,520.00m ² 。其中利用现有建筑建筑面积为 1,800.00m ² ，新增租赁办公楼建筑面积为 1,720.00m ²

2、项目经营前景

随着芯片设计复杂度的不断提升，SoC 芯片测试设备正朝着更高集成度、更高性能和更智能化的方向发展。本项目所研发的 ASIC 芯片，旨在为 SoC 测试设备提供高性能、定制化的解决方案，满足日益增长的测试需求。

从技术角度来看，ASIC 芯片的发展趋势包括先进制程工艺的持续演进、新型芯片架构的兴起以及异构计算的深入发展。本项目采用的 ASIC 芯片设计，能够充分利用先进制程工艺的优势，实现更高的性能和更低的功耗。同时，结合异构计算架构，ASIC 芯片能够更好地满足 SoC 测试设备在复杂场景下的多样化需求。

此外，SoC 测试设备行业正面临技术升级、市场细分和产业链整合的多重挑战。本项目的研发不仅能够提升测试设备的精度和速度，还将推动产业链上下游的协同发展，助力国内半导体产业的自主可控发展。随着 5G、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，对高性能 SoC 芯片的需求将持续上升，这也为本项目的市场前景提供了有力支撑。

综上所述，本项目不仅符合当前技术发展趋势，还将为行业带来创新性解决方案，具有重要的战略意义和广阔的应用前景。

3、与现有业务或发展战略的关系

本项目根据公司未来的发展规划，重点围绕全新一代基于自研 ASIC 芯片的国产化测试系统开展研发工作，为公司现有业务半导体自动化测试系统的未来产品布局做技术储备。本项目建成后，公司研发将具备测试系统的核心 ASIC 定义及架构设计能力，并以此构建长期稳定和可靠的测试系统核心 ASIC 供应链，打造全新一代基于自研 ASIC 芯片的国产化测试系统，与公司发展战略一致。

4、项目建设的必要性

（1）响应半导体产业国家发展战略，提升创新能力与国际竞争力

半导体产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，是调整经济发展方式、调整产业结构、保证国家信息安全的重要支撑，是衡量一个国家现代化程度及综合国力的重要标志。

我国目前已成为世界上最大的半导体消费市场，也在半导体生产上占据日益重要的地位。据集邦咨询（Trend Force）于 2023 年 12 月的预测，2023 年至 2027 年间中国大陆的成熟制程产能在全球的占比将自 31% 上升至 39%。这一显著的增长趋势表明，我国半导体产业在全球产业链中的地位日益重要，随着我国半导体产业的不断发展，上游晶圆产能的持续扩张以及先进封装等技术的推动，为国产测试设备厂商带来了难得的发展契机。

近年来，为助力我国半导体产业蓬勃发展，增强其创新能力与国际竞争力，国家相继颁布了一系列激励政策，诸如《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》（工信部联科〔2024〕12 号）、《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025 年）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等政策，大力支持技术领先的半导体设备企业发展，将创新置于现代化建设全局的核心位置，把科技自立自强视作国家发展的战略支撑。

本项目是公司响应半导体产业国家发展战略，提升创新能力与国际竞争力的重要举措。

(2) 实现 ASIC 芯片研发能力，加速推进国产高端测试机的研发进程

半导体测试系统是用于测试和验证半导体器件性能的复杂系统，需要多种类型的芯片来共同实现精确的测量、数据处理和控制功能。对高端测试系统来说，通用芯片已经无法满足其发展要求。未来，在面向超大规模集成电路芯片测试领域，通过自研 ASIC 芯片，才能打造出具备自主知识产权和国际竞争力的高端测试系统。

ASIC 芯片具备以下技术优势：1) 高集成度：可将大量的功能模块集成在 ASIC 芯片上，实现了高度的集成化，大大减少了测试设备中所用芯片的体积和引脚数量，也有助于降低测试系统的硬件成本和复杂度，进一步提升测试设备资源密度，满足复杂超大规模集成电路测试需求；2) 高测试精度：能够实现高精度的电压、电流、时间等参数测量，有助于在量产阶段评估验证及大规模测试集成电路的性能指标；3) 提高测试效率：部分具有高速处理能力和多通道并行处理能力的 ASIC 芯片，能够显著提升测试效率。在对超大规模集成电路进行测试时，可同时对多个通道并行测试，快速完成大量测试数据采集、处理及分析，缩短量产测试时间，提高集成电路生产效率，降低集成电路量产环节测试成本；4) 高可靠性和稳定性：经过严格的设计和测试流程，ASIC 芯片在高温、高湿度或强电磁干扰等复杂的测试环境下，相较分立方案具有更高可靠性和稳定性。

公司启动研发测试系统的 ASIC 芯片，不仅是满足市场需求和应对市场变化的技术挑战，也是推动公司技术创新和提升研发能力的重要契机，有助于公司积累技术经验，培养一流的技术团队，进一步提高产品附加值，增强公司在国内外市场的核心竞争力。

(3) 提升半导体测试系统自主可控水平，保障供应链安全性

当前全球半导体产业正面临复杂的国际形势，打造国产供应链的半导体测试系统，有助于提升国内半导体产业的自主可控能力，保障产业链安全。目前我国对半导体行业的自主可控需求迫切，特别是在“新基建”和“芯片自主”的背景下，研发自主可控的半导体测试系统已成为国家战略中的重要组成部分。提升国产测试系统的技术水平和市场份额，打破国外企业的垄断，实现测试系统的国产化，已成为我国半导体产业发展的迫切需求。因此，半导体测试设备供应链自主可控意义重大且影响深远，其关乎国家半导体产业的稳健安全，自主可控的供应链，不仅能确保设备的稳定供应，还可有效抵御国外技术封锁，使企业得以按自身节奏实现技术升级与产品研发。

自研 ASIC 芯片和超大规模集成电路芯片需求的测试系统，不仅有助于提升公司的市场竞争力，还能保障公司产业链的安全稳定。本项目将有助于打造供应链自主可控的半导体测试系统，与国家推动关键核心技术攻关和实现科技突破的战略高度契合。

5、项目建设的可行性

(1) 国家产业政策的大力支持为项目实施提供了良好的环境

近年来，国家及地方从研发、人才、知识产权、进出口、市场应用、财税、投融资、国际合作等维度制定多项促进政策，进一步优化半导体产业的发展环境，鼓励半导体产业提升创新能力，打破国外垄断，实现跨越式发展。根据国家战略发展规划，预计未来国家将出台更多有利于半导体行业的支持政策，为本项目的顺利实施提供充分的政策支持与保障。

(2) 公司具备开展研发项目的相关技术储备

技术方面，公司在模拟、混合、功率和 SoC 领域突破了多项关键核心技术，已成功开发高可靠、高精度、高效率的测试系统，装机量逐年攀升。截至 2025 年 12 月 31 日，全球装机量已经突破 8,000 台。庞大的装机量和核心技术的积累为 ASIC 芯片的研发提供了强大的助力。目前，公司是为数不多向国内外知名芯片设计公司、晶圆厂、IDM 和封测厂商供应半导体测试系统的中国企业。

公司成立至今，一直坚持在产品技术创新和研发方面保持高强度的投入，经过三十多年的研发投入和技术迭代，公司拥有模拟、数模混合、射频、SoC、存储器、分立器件、功率模块等测试领域的诸多核心技术，包括 V/I 源、精密电压电流测量、高速数字波形发生与采集、射频及混合器件测试、存储器件测试、宽禁带半导体测试和智能功率模块测试等。同时也建立了一套行之有效的研发体系，具备长期持续的研发投入能力。

(3) 公司具备开展研发项目的组织体系与人才储备

公司具备经验丰富的管理团队，均拥有丰富的半导体自动化测试系统行业从业经验，拥有扎实的专业能力和丰富的管理经验，能够准确把握行业和公司发展方向，制定符合公司实际的研发战略，对公司技术研发的演进起到了关键作用。公司研发组织体系高效，分工明确，流程严谨，创新与需求紧密结合，层层验证、监督，统筹所研究技术的先进性与落地性。

人才方面，公司制定了全面的内部培训计划，通过定期的培训课程和实践项目，提升员工的专业技能和综合素质；并与多所高校和科研机构合作，建立实习基地和联合实验室，培养了一批高素质的科研人才。公司还通过多种渠道引进高端人才，为公司的技术创新提供了有力支持。

6、项目的投资概况

本项目总投资 75,888.00 万元，拟使用募集资金 74,947.50 万元。项目总投资构成情况见下表：

单位：万元

序号	总投资构成	投资额	比例	拟使用募集资金投资金额	比例
1	建设投资	75,888.00	100.00%	74,947.50	100.00%
1.1	建筑工程费	344.00	0.45%	344.00	0.46%
1.2	设备及软件购置费	4,930.60	6.50%	4,930.60	6.58%
1.3	安装工程费	-	-	-	-
1.4	工程建设其他费用	70,427.06	92.80%	69,672.90	92.96%
1.4.1	前期工作费	49.46	0.07%	49.45	0.07%
1.4.2	研发费用	69,122.00	91.08%	69,122.00	92.23%
1.4.3	租赁费	1,255.60	1.65%	501.45	0.67%
1.5	预备费	186.34	0.25%	-	-
2	建设期利息	-	-	-	-
3	铺底流动资金	-	-	-	-
合计		75,888.00	100.00%	74,947.50	100.00%

7、项目的实施准备和进展情况、预计实施时间，整体进度安排

本项目建设期拟定为 4 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、场所租赁及装修改造、设备购置安装及调试、人员招聘与培训、课题研究，具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
1	项目前期准备												
2	场所租赁及装修改造												
3	设备购置、安装及调试												
4	人员招聘与培训												

序号	建设内容	月份											
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	课题研究												

8、项目预计经济效益、效益测算的假设条件及主要计算过程

本项目为研发创新项目，有利于提高公司研发测试系统的核心 ASIC 定义及架构设计能力，提升公司核心竞争力，不直接生产产品，不直接产生经济效益。

三、本次募集资金用于研发投入的情况

本次募投项目“基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目”部分募集资金用于研发投入，相关研发费用不涉及资本化，具体情况如下：

（一）研发投入的主要内容及技术可行性

本项目建成后，公司研发将具备测试系统的核心 ASIC 定义及架构设计能力，并以此构建长期稳定和可靠的测试系统核心 ASIC 供应链，打造全新一代基于自研 ASIC 芯片的国产化测试系统，减少对外部专用芯片供应商资源的依赖，提升公司核心竞争力，继续保持行业竞争优势地位。

从技术角度来看，ASIC 芯片的发展趋势包括先进制程工艺的持续演进、新型芯片架构的兴起以及异构计算的深入发展。本项目采用的 ASIC 芯片设计，能够充分利用先进制程工艺的优势，实现更高的性能和更低的功耗。同时，结合异构计算架构，ASIC 芯片能够更好地满足 SoC 测试设备在复杂场景下的多样化需求，具有技术可行性。

（二）研发预算及时间安排

本项目研发费用 69,122.00 万元，其中人员工资 29,424.00 万元，其他研发费用 39,698.00 万元。项目时间安排详见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（一）基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目”之“7、项目的实施准备和进展情况、预计实施时间，整体进度安排”。

（三）目前研发投入及进展

公司目前研发投入及进展详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、技术与研发情况”相关内容。

（四）预计未来研发费用资本化情况

本项目不涉及研发费用资本化情况。

（五）已取得及预计取得的研发成果

公司目前在模拟及数模混合类、功率类、SoC 类集成电路自动化测试系统领域具有竞争优势，已掌握十四项核心技术，均应用于公司主营业务。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已获得授权且尚在有效期内境内外的专利共 236 项，其中包括 75 项发明专利、145 项实用新型专利和 16 项外观设计专利。

本项目建成后，公司研发将具备测试系统的核心 ASIC 定义及架构设计能力，并以此构建长期稳定和可靠的测试系统核心 ASIC 供应链，打造全新一代基于自研 ASIC 芯片的国产化测试系统。

四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务

（一）本次募集资金投资于科技创新领域的说明

公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。产品主要用于模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路的测试，销售区域覆盖中国大陆、中国台湾省、美国、欧洲、日本、韩国、东南亚和印度等全球半导体产业发达的国家和地区。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 74,947.50 万元（含 74,947.50 万元），扣除发行费用后净额将用于基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目，系围绕公司主营业务展开。

2021 年 3 月，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出要深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路等产业创新发展。2022 年 12 月，中共中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》，提出全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。2023 年 8 月，工信部和财政部发布《关于印发电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案的通知》（工信部联电子〔2023〕132 号），提出落实《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》及各项细则，落实集成电路企业增值税加计抵减政策，协调解决企业在享受优惠

政策中的问题。面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力。

根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》及国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业属于战略性新兴产业的重要组成部分。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2024年4月修订），公司所在行业属于科创板重点推荐的“新一代信息技术”领域中的“半导体和集成电路”。公司产品以国家战略性需求为导向，服务于国家创新驱动发展战略及制造强国战略，积极响应产业政策及发展规划。

综上，本次募集资金投资项目将紧密围绕公司主营业务和科技创新领域开展，项目实施后将提升公司产品的测试能力和保障供应链安全，进一步实现自主可控。本次募集资金投资项目符合国家产业政策，属于科技创新领域。

（二）募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

通过本次募投项目“基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目”的实施，公司将具备测试系统的核心 ASIC 定义及架构设计能力，为后续高端 SoC 测试系统国产化做好技术准备，并以此构建长期稳定和可靠的测试系统核心 ASIC 供应链，打造全新一代基于自研 ASIC 芯片的国产化测试系统，减少对外部专用芯片供应商资源的依赖，提升公司核心竞争力。

五、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的运用符合国家相关的产业政策及公司总体战略发展方向，与公司现有主业紧密相关。本次募集资金投向是公司依托现有技术储备和研发能力，重点围绕全新一代基于自研 ASIC 芯片的国产化测试系统开展研发工作，有利于公司构建长期稳定和可靠的测试系统核心 ASIC 供应链，打造全新一代基于自研 ASIC 芯片的国产化测试系统，提升公司综合竞争力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础。

（二）对公司财务状况的影响

本次向不特定对象发行可转债募集资金到位后，公司的货币资金、总资产和总负债

规模将相应增加，可为公司的后续发展提供有力保障。本次可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转债持有人未来陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

本次发行募集资金到位后，可能短期内会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定幅度摊薄，但本次可转债募集资金投资项目符合国家产业政策要求和行业市场发展趋势，公司长期盈利能力将会得到显著增强，经营业绩预计会有一定程度的提升。

六、公司主营业务及募投项目符合国家产业政策

发行人主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。产品主要用于模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路的测试。

（一）公司主营业务所属行业分类情况

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年修订），发行人属于专用设备制造业（行业代码：C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人属于专用设备制造业中的电子和电工机械专业设备制造下的半导体器件专用设备制造（行业代码：C3562）。发行人所在行业属于科创板重点推荐的“新一代信息技术”领域中的“半导体和集成电路”。

根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016年版），公司的主营业务所属行业为“1.3 电子核心产业”的“1.3.1 集成电路”类。

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务所属行业为“1.2.4 集成电路制造”类。

综上，公司主营业务属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016年版）和《战略性新兴产业分类（2018）》中所列的战略性新兴产业。

（二）本次募投项目所属行业分类情况

“基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目”属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016年版）的“1.3.1 集成电路”类以及《战略性新兴产业分类（2018）》的“1.2.4 集成电路制造”类。

本次募投项目是结合行业发展趋势和客户实际需求，基于公司主营业务以及核心技

术开发情况所进行的战略布局和投资计划。公司本次募投项目属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016年版）和《战略性新兴产业分类（2018）》中所列的战略性新兴产业。

（三）公司主营业务及募投项目符合国家产业政策

2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》（工信部联科〔2024〕12号），重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展。发展智能制造、生物制造、纳米制造、激光制造、循环制造，突破智能控制、智能传感、模拟仿真等关键核心技术，推广柔性制造、共享制造等模式。

2023年8月，工信部、财政部发布《关于印发电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案的通知》（工信部联电子〔2023〕132号），落实《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》及各项细则，落实集成电路企业增值税加计抵减政策，协调解决企业在享受优惠政策中的问题。面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力。

2022年12月，中共中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，提出全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。

2021年3月国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出推动制造业优化升级：深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路等产业创新发展。

综上所述，本次向不特定对象发行可转换公司债券是公司构建长期稳定和可靠的测试系统核心ASIC供应链，打造全新一代基于自研ASIC芯片的国产化测试系统，实现公司战略发展目标的重要举措。公司主营业务及本次发行的募集资金投向符合国家产业政策和公司战略发展规划。

七、公司具有“轻资产、高研发投入”的特点

根据《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第6号——轻资产、高研发投入认定标准（试行）》（以下简称“《6号指引》”）第三条及第四条关于“轻资产、高研发投入”的认定标准要求，公司具有轻资产、高研发的特点，具体情况如下：

（一）公司具有轻资产的特点

截至2025年末，公司固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重情况如下所示：

单位：万元

项目	金额	占总资产的比例
固定资产	42,183.11	9.37%
土地使用权	1,848.72	0.41%
使用权资产	2,388.77	0.53%
长期待摊费用	364.34	0.08%
合计	46,784.94	10.39%

截至2025年末，公司固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重为10.39%，符合《6号指引》中第三条规定的“轻资产”认定标准，即“最近一年末固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重不高于20%”。

（二）公司具有高研发投入的特点

2023年度至2025年度，公司研发投入占营业收入比重情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度	平均值
研发投入	26,571.67	17,236.82	13,198.02	19,002.17
营业收入	134,641.06	90,534.54	69,086.19	98,087.48
研发投入占营业收入的比例	19.74%	19.04%	19.10%	19.37%

2023 年度至 2025 年度，公司最近三年平均研发投入占营业收入比例为 19.37%，最近三年累计研发投入 57,006.51 万元。截至 2025 年末，公司研发人员共 486 人，占公司当年员工总人数的 51.32%。报告期内，公司研发投入及研发人员情况符合《6 号指引》第四条规定的“高研发投入”认定标准，即“最近三年平均研发投入占营业收入比例不低于 15%或者最近三年累计研发投入不低于 3 亿元，且最近一年研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%”。

第六节 备查文件

- (一) 发行人最近三年的财务报告及审计报告；
- (二) 保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (三) 法律意见书和律师工作报告；
- (四) 董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的审核报告；
- (五) 资信评级机构出具的资信评级报告；
- (六) 中国证监会对本次发行予以注册的文件；
- (七) 其他与本次发行有关的重要文件。

(本页无正文,为《北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》之签章页)

北京华峰测控技术股份有限公司

